

股票代號：4768



晶呈科技股份有限公司
Ingentec Corporation

一一三年度年報

公司網址：<https://www.ingenteccorp.com.tw/>

年報查詢網址：<https://mops.twse.com.tw/>

刊印日期：中華民國一一四年四月三十日

一、發言人及代理發言人資料：

(一)本公司發言人：

姓 名：張 永 宏
職 稱：處長
電 話：+886-37-585218
電子郵件信箱：tony@ingentecorp.com.tw

(二)代理發言人：

姓 名：王 起 明
職 稱：副總經理
電 話：+886-37-585218
電子郵件信箱：michael@ingentecorp.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總公司及竹南製造一廠地址：苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號
竹南製造二廠地址：苗栗縣竹南鎮真如路253巷32號
電話：+886-37-585218
台南分公司地址：臺南市永康區新民街33號1樓
電話：+886-6-2433243

三、股票過戶機構：

名 稱：國票綜合證券股份有限公司股務代理部
住 址：105411 台北市松山區南京東路五段 188 號 15 樓
網 址：<https://www.ibfs.com.tw/>
電 話：+886- 2-25288988

四、最近年度財務報告簽證會計師：

簽證會計師：于智帆會計師、黃世鈞會計師
事務所名稱：資誠聯合會計師事務所
地 址：台北市基隆路一段 333 號 27 樓
網 址：<https://www.pwc.tw/>
電 話：+886-2-27296666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：<https://www.ingentecorp.com.tw/>

目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	7
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	7
二、最近年度支付董事（含獨立董事）、總經理及副總經理之酬金.....	13
三、公司治理運作情形.....	18
四、簽證會計師公費資訊.....	44
五、更換會計師資訊.....	45
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者.....	45
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	45
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊.....	46
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	46
參、募資情形	47
一、資本及股份.....	47
二、公司債辦理情形.....	50
三、特別股辦理情形.....	50
四、海外存託憑證辦理情形.....	50
五、員工認股權憑證辦理情形.....	50
六、限制員工權利新股辦理情形.....	50
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	50
八、資金運用計畫執行情形.....	50
肆、營運概況	51
一、業務內容.....	51
二、市場及產銷概況.....	62
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料.....	68
四、環保支出資訊.....	68

五、勞資關係.....	68
六、資通安全管理.....	70
七、重要契約.....	70
伍、財報狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	71
一、財務狀況.....	71
二、財務績效.....	71
三、現金流量.....	72
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	72
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 ...	72
六、最近年度及截至年報刊印日止，風險事項分析評估.....	73
七、其他重要事項.....	76
陸、特別記載事項	77
一、關係企業相關資料.....	77
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	77
三、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	77
四、其他必要補充說明事項.....	77

壹、致股東報告書

各位股東先進：

感謝大家對晶呈科技長期的支持與信任，謹就 113 年度營運概況、114 年度營運計劃暨未來營運展望說明如下：

一、113 年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

113 年國際半導體業擺脫 112 年景氣下行的窘境，年產值達 6,260 億美元，較 112 年成長 18.1%(資料來源：Gartner)。終端需求回升主要表現在資料中心及記憶體等應用，雖有中美科技戰爭持續干擾，本公司 113 年營運較 112 年為佳。本公司 113 年度合併營收為新台幣 1,016,860 仟元，較 112 年度合併營收新台幣 815,208 仟元增加 25%；營業毛利 412,733 仟元，稅後淨利為 154,682 仟元，每股盈餘為新台幣 2.90 元。

(二)預算執行情形

本公司 113 年度無對外公開財務預測，故不適用。

(三)財務收支及獲利能力分析

1.財務收支

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	112 年度	增(減)金額	增(減)比例
利息收入	4,399	4,588	(189)	(4.12%)
利息支出	8,595	5,797	2,798	48.27%

2.獲利能力

項 目	113 年度	112 年度
資產報酬率(%)	7.09%	5.85%
權益報酬率(%)	9.50%	7.37%
稅前純益佔實收資本額報酬率(%)	42.33%	37.66%
純益率(%)	15.21%	14.33%
每股盈餘(元)	2.90	2.63

(四)研究發展狀況

晶呈科技重視研究發展，持續增加研發費用。113 年度之研發費用為新台幣 78,833 仟元，112 年度之研發費用為新台幣 62,082 仟元，其金額分別佔該年度營收比例之 8%及 8%，113 年研發費用較 112 年成長 27%。

113 年研發項目說明如下：

研發項目	技術特點與應用	未來成效
氣態分解溶蝕技術	係本公司自主技術多年研發並申請專利之設備，採乾式氣態方式去除標的物表面薄膜。目前已開發至第三代自動化生產設備。由於製程中使用毒性氣體化學品，此設備兼具安全設計、符合環保極低化學品使用量及高度生產效能。目前主要應用於半導體矽晶圓之晶圓重生(ReBirth)，為半導體客戶去除矽晶圓表面多樣複雜膜種，和傳統濕式化學品表面除膜相比，具有僅 1%化學品使用量、高良率及數倍晶圓重生次數之成本競爭優勢。已建置每個月 4 萬片產能服務客戶，其他應用同步展開。 未來以每月生產 4 萬片為一個模組生產線，逐步展開擴廠計畫。 導磁膜散熱技術衍生的 Transvivi Pixel 封裝技術，並結合氣態分解溶蝕技術，所研發出來玻璃通孔載板產品 (TGV; Through Glass Via)，稱為 Laser Arrow Decomposition Yield (LADY) 雷射劍融蝕擴孔技術，可應用於高階人工智慧晶片封裝產業，目前已初步通過客戶認證，2025 年 Q3 將會於晶呈設立一座 LADY TGV 工廠，供應客戶的需求。	半導體廠因應成本考量與先進製程多樣複雜膜種除膜難度增加，In-house Dummy wafer Reclaim 已是主流製程，每年穩定成長。保守估計，一座 12 吋半導體廠每個月矽晶圓高難度表面除膜需求約 4 千~5 千片，以全球約 138 座 12 吋半導體廠估算，市場需求相當可觀，可期待能提升晶呈科技營運成長動能。 目前和台灣、日本、新加坡等地客戶進行產品驗證並陸續接單。 TGV 載板，是未來高階封裝所必需的高階封裝材料，特別是 AI 高階晶片需求龐大，此趨勢下，TGV 的需求會逐年大幅增加，前景可期。
導磁膜散熱技術	係本公司自主技術多年研發之特殊金屬複合式材料，並已申請製程與應用專利。晶呈科技稱此特殊金屬複合式材料為銅磁晶片(CMW，Copper Magnetic Wafer)。其特點為具備磁吸特性、可客製所需要的尺寸及厚度、可化學式切割及高度散熱性，目前主要應用於 Mini LED 及 Micro LED，做為發光層之承載基板。 發揮此材料多樣化特性，晶呈科技透過磁性巨量微整列做晶粒巨量轉移，進一步開發出“大功率紅光 LED 晶粒”，主要應用在照明、燈號與車用產業；“銅磁微發光二極體(CMuLED，Copper Magnetic Micro LED)”、“0404 TFE 頂面射光畫素	本公司運用銅磁晶片於 Mini & Micro LED 是一個創新技術，可解決目前業界其他技術上所面臨的無基板巨量轉移低良率高成本的困境。 根據 TrendForce 旗下光電研究處發佈的《LED 產業需求與供給資料庫》顯示，2024~2030 年全球 Mini/Micro LED 市場規模

	封裝體(TFE, Top Face Emitting)”及“透明畫素封裝體(TransVivi Pixel)”, 主要應用在各尺寸“直顯透明”、“非透明顯示屏”及“背光顯示屏”。此外, 本技術可對垂直共振腔面射型雷射(VCSEL) 有散熱的效果, 可增加 VCSEL 的發射距離, 對於光達雷射(LiDar) 有感測距離增加的優勢, 與學術單位展開 CMW 應用於 VCSEL 的前期基礎研究後, CMW 已具備 VCSEL 應用潛力。	每年將達 60 億美元。本公司的產品一旦產出獲市場認證, 營收與獲利高速成長可期。CMW 在 VCSEL 的應用若於潛在客戶驗證成功後, 可增加 CMW 的銷售實績。
電子氣體研發	氣體為半導體產業的血液, 用於半導體的氣體品項高達 200 項以上, 諸多品項仍需從國外進口, 故本公司投入研發資源, 針對台灣欠缺的電子氣體品項, 持續進行開發, 有利於本土供應鏈的韌性強化。	目前開發的品項計有 BCL3、F2/N2、AHF、CO、C4F6...等, 預計研發完成導入量產後, 可大幅增加公司營收效益。
去光阻液研發	去光阻液為半導體製程中必備的化學品, 目前主要的供應商皆為外商, 本公司投入資源, 進行去光阻液的研發, 將有助於本土供應鏈的韌性提升, 及提高公司在濕化學品的技術能力。	目前已開發出 13 個去光阻液品項, 將陸續通過客戶認證及導入量產線, 預期將為公司增加可觀之營收與獲利。

二、114 年度營業計劃概要

(一) 經營方針

- (1) 以現有之核心技術為基礎, 研發新的商業應用。
- (2) 研發新技術, 創造或發現藍海市場。
- (3) 持續開發代理商品, 發掘商機及技術開發機會。
- (4) 依照區域市場特性, 優化海外佈局, 強化銷售通路。
- (5) 專注關鍵特殊材料技術研發及在地生產, 填補產業空缺。
- (6) 永續願景: 成為全球最大特殊材料專業製造商與應用技術提供者。

(二) 預期銷售數量及其依據

- (1) 特殊氣體: 隨著客戶需求增加, 預期出貨 2,000 支鋼瓶/月。
- (2) 晶圓重生: 通過更多客戶認證並取得訂單, 預期銷售 40,000 片矽晶片/月。
- (3) 銅磁晶片系列產品: 預期將此新產品與新技術成功導入市場, 讓市場接受。
- (4) 玻璃載板系列產品: 此為高階封裝及 Transvivi Pixel 所需的材料, 預估市場可期待。
- (5) 去光阻液: 以 288 噸年產能為一個生產模組, 具備 4 個模組生產與銷售能力。
- (6) 貿易商品: 爭取更高市佔率及新項目開發。

(三) 重要之產銷政策

(1) 特殊氣體：

- a. 提高在客戶端市佔率。
- b. 推展新產品，完成測試驗證，取得訂單。
- c. 提供符合客戶要求之品質與服務，確保出貨順暢。
- d. 關注客戶產能增減變化，適時因應調整對應庫存量。
- e. 關注環保氣體應用可能的趨勢。

(2) 晶圓重生：

- a. 通過更多客戶認證，取得訂單。
- b. 快速完成客戶高難度膜種去膜參數設定，爭取訂單。

(3) 銅磁晶片系列產品：

- a. 進行 Transvivi Pixel 量產。
- b. 完成樣品測試驗證，加速終端應用。
- c. 積極應對客戶需求，縮短產品驗證期間。

(4) 玻璃載板系列產品：

- a. 通過更多客戶認證，取得訂單。
- b. 完成樣品測試驗證，加速終端應用。
- c. 積極應對客戶需求，縮短產品驗證期間。

(5) 去光阻液：

- a. 通過更多客戶認證，取得訂單。
- b. 建立環保及安全的工廠，提供足夠產能。

(6) 貿易商品：

- a. 提高在客戶端市佔率。
- b. 推展新產品、新客戶。
- c. 開發產品之新應用。

三、未來公司發展策略

(一) 乾式化學品精餾技術：

- (1) 本公司轉投資之亞欣達特殊材料一廠已於 107 年 8 月量產，主要製造 C4F8(八氟環丁烷),113 年完成在原址增加 C4F6 的精餾製造,預估年產能 100 噸。二廠土地已完成建廠規劃，廠房陸續建置中。三廠已取得，廠房建置中。
- (2) 持續增加特殊氣體在地化製造銷售品項。
- (3) 開拓日本、新加坡、韓國、美國等海外市場銷售。
- (4) 持續開發應用於半導體先進製程特殊氣體品項。

(二) 氣態分解溶蝕技術：

- (1) 本公司已建置矽晶圓晶圓重生 4 萬片/月為一模組產能服務客戶，視客戶需求增加會進行模組化產能擴充，滿足客戶需求。
- (2) 持續優化製程，降低成本，提升競爭優勢。
- (3) 持續開發新應用。
- (4) 設立 LADY 製程的玻璃通孔(TGV) 載板工廠，供應給高階晶片封裝產業客戶。

(三) 導磁膜散熱技術：

- (1) 本公司計畫建置新研發成果的透明畫素封裝體(TransVivi Pixel)400 萬顆/月產能以服務客戶，視客戶需求增加會進行產能擴充，滿足客戶需求。
- (2) 持續優化銅磁晶片(MW, Copper Magnetic Wafer)、大功率紅光 LED 晶粒、銅磁微發光二極體(CM μ LED, Copper Magnetic Micro LED)及透明畫素封裝體(TransVivi Pixel)之製程與技術，降低成本，促進產品在 Mini LED 及 Micro LED 市場普及化。
- (3) 進行 CMW 應用於垂直共振腔面射型雷射(VCSEL)的業界應用推廣。

(四) 電子氣體產品技術：

- (1) 因半導體產業對電子氣體的品項需求高達 200 種以上，諸多品項仍需從國外進口，基於本公司在氣體產業的經驗，持續投入研發資源，可增加電子氣體產品品項，強化台灣半導體的氣體供應鏈韌性，及增加公司營收利益。
- (2) 開發中的品項計有 BCL3、AHF、CO、F₂/N₂、C₄F₆...等。

(五) 去光阻液：

- (1) 去光阻液為半導體製程中必備的化學品，本公司投入資源，進行去光阻液的研發，將有助於本土供應鏈的韌性提升，及提高公司在濕化學品的技術能力。
- (2) 目前已開發出 13 個去光阻液品項，將陸續通過客戶認證及導入量產線，預期將為公司增加可觀之營收與獲利。

(六) 貿易商品：

- (1) 現有商品持續增加市佔率及開發新應用。
- (2) 持續引進代理商品，擴大營運規模。
- (3) 從代理商品中發現在地化製造商機，建立自有技術，落實在地化製造。

本公司藉由持續提昇專業與服務，成為有能力解決客戶需求及提供客戶附加價值的公司，期望在新產品挹注與產線建置後效益顯現，帶動每年營收與獲利成長，持續發展新市場、新客戶，提高市場占有率，拓展外銷，力求市場全球化以擴大業務規模，強化成長動能。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

在中美貿易戰及俄烏戰爭持續影響下，全球經濟動盪不安，電子產業終端需求雖有提升，但仍處於庫存調整狀態，即使部份半導體產能閒置，試圖引導市場運作趨於健康化，仍無法減緩供過於求之壓力，半導體需求成長性仍然受阻。

晶呈科技集團專注於技術開發，有多項新產品技術持續開發中，待技術開發成熟投入生產，將促進未來營運持續成長。我們將持續以穩健的步伐，強化公司競爭優勢，關注產業脈動，掌握商機並規避風險，引導公司永續發展。

再次誠摯地感謝全體股東過去一年以來的支持與指導！

在此 敬祝全體股東

身體健康 萬事如意

董事長兼總經理 陳亞理



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事資料

1. 董事資料：

114 年 03 月 29 日

職稱	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡	初次 選任 日期	選任 日期	任期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年 子女現在持 有股份		利用他人名 義持有股份		主要 經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主管 或董事			備註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	陳亞理	男 51~60	99.12.09	111.06.29	3 年	5,003,053	13.96%	5,660,341	12.52%	-	-	504,409	1.12%	美國密西根塞基諾州立大學企業管理碩士 中德電子材料(股)公司銷售業務處長 利機企業(股)公司通路事業部副總經理	本公司總經理 南京晶咏呈新材料有限公司 執行董事 亞欣達特殊材料(股)公司董事長 兼總經理 理瑞投資實業有限公司董事 創視媒體科技(股)公司董事長	-	-	-	(註 1)
董事	中華民國	張惟傑	男 31~40	105.03.10	111.06.29	3 年	845,608	2.36%	1,045,444	2.31%	-	-	-	-	英國卡迪夫大學企管系碩士 亞欣達特殊材料(股)公司製造運行總部副 理	-	-	-	-	
董事	中華民國	王起明	男 51~60	106.06.15	111.06.29	3 年	94,760	0.26%	55,670	0.12%	-	-	-	-	清華大學材料工程研究所碩士 聯華電子(股)公司製程工程師 立生半導體(股)公司客服部經理 利機企業(股)公司產品部經理	本公司副總經理 南京晶咏呈新材料有限公司監事 亞欣達特殊材料(股)公司董事長 副總經理	-	-	-	-
董事	中華民國	姜守危	男 61~70	99.12.09	111.06.29	3 年	208,867	0.58%	230,835	0.51%	568	0.00%	-	-	東吳大學法學系 北京大學法學碩士	-	-	-	-	
獨立 董事	中華民國	李慶超	男 71~80	108.12.27	111.06.29	3 年	-	-	7,268	0.02%	7,268	0.02%	-	-	美國麻省理工學院管理科學碩士 中德電子材料股份有限公司總經理 中鋼運通股份有限公司董事長 中國鋼鐵股份有限公司執行副總經理	茂迪股份有限公司獨立董事 慶康科技股份有限公司獨立董事 子維投資有限公司董事 美詰國際企業(股)公司法人董事 代表人	-	-	-	-
獨立 董事	中華民國	黃健騰	男 71~80	108.12.27	111.06.29	3 年	-	-	-	-	-	-	-	-	國立臺灣海洋學院輪機工程學系學士 上海吉威電子系統工程有限公司總經理	-	-	-	-	

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	初次 選任 日期	選任 日期	任期	選任時 持有股份		現 持有股數		配偶、未成年 子女現在持 有股份	利用他人名 義持有股份		主要 經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主管 或董事			備註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數			職稱	姓名	關係	
獨立 董事	中華 民國	張木田	男 51~60	108/12/27	111/06/29	3 年	-	-	-	-	220,566	0.49%	-	英國萊斯特大學企管管理碩士 聯相光電股份有限公司資深副總經理	捷得實科技股份有限公司副總經理	-	-	-	-

註 1：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：

本公司董事長兼任總經理，係為提升經營效率與決策執行力，惟為強化董事會之獨立性，公司內部已積極培訓合適人選；此外，董事長平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況與計劃方針以落實公司治理，未來本公司亦擬規劃增加獨立董事席次之方式提升董事會職能及強化監督功能。目前本公司已有下列具體措施：

- 1.現任三席獨立董事分別在財務會計與半導體產業領域學有專精，能有效發揮其監督職能。
- 2.獨立董事在各功能性委員會皆可充分討論並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。
- 3.每年度安排各董事參加證基會等外部機構專業董事課程，以增進董事會之運作效能。
- 4.董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人。

2. 法人股東之主要股東：無法人股東擔任董事，故不適用。

3. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
陳亞理	陳亞理先生曾任職於中德電子材料(股)公司銷售業務處長及利機企業(股)公司通路事業部副總經理。專精於半導體及光電之精密化學品產業之經營與策略管理已逾 32 年。在董事會以董事長之角色，向所有董事進行相關經營管理之策略溝通與互動，且具備商務、市場行銷及產業科技能力。	依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，且為健全董事會功能及強化管理機制，本公司於民國 110 年 9 月 16 日設置提名委員會，本委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中有過半數獨立董事參與。本公司於董事會成員之提名與遴選時，已獲得每位董事的書面聲明、工作經歷、目前任職證明，以及提供之親屬關係表以予核實，已確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性；且另經核實左列三位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	-
張惟傑	張惟傑先生專注於半導體及光電之精密化學品產業之經營與策略管理超過 8 年，具備公司治理、商務、市場行銷及產業科技能力，能適時對本公司董事會提出相關公司治理及營運管理意見與方針，以要求經營團隊擬定營運策略據以執行。		-
王起明	王起明先生專注於半導體及光電之精密化學品產業之經營與策略管理超過 26 年，具備公司治理、商務、市場行銷及產業科技能力，能適時對本公司董事會提出相關公司治理及營運管理意見與方針，以要求經營團隊擬定營運策略據以執行。		-
姜守危	姜守危先生曾任職於陸台國際有限公司總經理，熟稔公司治理、商務、市場行銷及產業科技能力逾 8 年，能適時對本公司董事會提出相關廠務及營運管理相關寶貴意見。		-
李慶超	台灣大學商學系學士、成功大學工業管理碩士及美國麻省理工學院管理科學碩士畢業，並曾任職於中德電子材料(股)公司總經理、中鋼運通股份有限公司董事長及中國鋼鐵(股)公司執行副總經理。具財務及會計專業及實務經驗，管理實務經驗豐富，借重其專才以提升董事會公司治理管理品質及審計委員會監督功能，且並無違反公司法第 30 條各款之情事。		2
黃健騰	台灣海洋學院輪機工程學系學士畢業，並曾任職於上海吉威電子系統工程有限公司總經理。具實務經驗，管理實務經驗豐富，借重其專才以提升董事會公司治理管理品質及審計委員會監督功能，且並無違反公司法第 30 條各款之情事。		-
張木田	英國萊斯特大學企業管理碩士畢業，並曾任職於聯相光電(股)公司資深副總經理及捷得寶科技(股)公司副總經理。具實務經驗，管理實務經驗豐富，借重其專才以提升董事會公司治理管理品質及審計委員會監督功能，且並無違反公司法第 30 條各款之情事。		-

4. 董事會多元化及獨立性：

(1) 董事會多元化：

本公司董事會成員組成依據「公司治理實務守則」第二十條與「董事選任程序」第三條從多個方面考慮董事會成員多元化。本公司共有 7 席董事(包含 3 席獨立董事)，年齡區間涵蓋 31~80 歲。本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本條件與價值，如：性別及年齡，也各自具有產業經驗與專業能力，如：營業判斷、財務會計、經營管理、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。

多元化政策之具體管理目標及達成情形：

管理目標	達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一	達成
適足多元之專業知識與技能	達成
獨立董事任期未逾三屆	達成
女性董事至少一席	未達成（預計下屆全面改選時選任）

本公司歷屆董事會成員均由不同專長領域之人員組成，本屆成員之多元化核心項目如下表：

核心項目 職稱姓名		性別	獨董占全體董事比例	具員工身份之董事占全體董事比例	年齡分佈		產業經驗/專業能力							
					50歲以下	50歲以上	營運判斷	財務會計	經營管理	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
董事長	陳亞理	男	43%	29%	14%	86%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	張惟傑	男					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	王起明	男					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	姜守危	男					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	李慶超	男					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	黃健騰	男					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	張木田	男					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(2) 董事會獨立性：

本公司設置董事席次共 7 席，其中獨立董事 3 席，達全體席次之 43%，並依法設置審計委員會取代監察人，董事間並無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，執行相關職權應具有獨立性。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年03月29日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	比率	股數	比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	陳亞理	男	100/1/1	5,660,341	12.52	-	-	504,409	1.12	美國密西根塞基諾州立大學企業管理碩士 中德電子材料(股)公司銷售業務處長 利機企業(股)公司通路事業部副總經理	南京晶咏呈新材料有限公司執行董事 亞欣達特殊材料(股)公司董事長 兼總經理 理瑞投資實業有限公司董事長 創視媒體科技(股)公司董事長	無	無	無	註1
氣體生產 暨貿易事 業群副總 經理	中華民國	王起明	男	100/1/1	55,670	0.12	-	-	-	-	清華大學材料工程研究所碩士 聯華電子(股)公司製程工程師 立生半導體(股)公司客服部經理 利機企業(股)公司產品部經理	南京晶咏呈新材料有限公司監事 亞欣達特殊材料(股)公司董事兼 副總經理	無	無	無	-
行政支援 處處長	中華民國	張永宏	男	108/10/31	670,474	1.48	180,501	0.40	-	-	陽明交通大學高階管理學碩士(EMBA) 中德電子材料(股)公司業務主任 利機企業(股)公司業務部經理	台灣芯電應用科技(股)公司董事 創視媒體科技(股)公司董事	無	無	無	-
研發處 處長	中華民國	馮祥鉸	男	108/10/31	75,881	0.17	48,540	0.11	-	-	清華大學化學研究所碩士 聯華電子(股)公司研發部正工程師 利機企業(股)公司研發部經理	台灣芯電應用科技(股)公司董事 長	無	無	無	-
品質處 處長	中華民國	林峯華	男	113/1/1	-	-	-	-	-	-	文化大學化工系學士 新加坡商砂比科亞洲有限公司經理 美商普拉克西艾爾科技股份有限公司台灣 分公司亞洲區材料開發經理	-	無	無	無	-
財務部 經理	中華民國	李妍蓉	女	100/1/1	221,488	0.49	-	-	-	-	靜宜大學會計系學士 智華會計師事務所領組	-	無	無	無	-
會計部 經理	中華民國	鄭雅玲	女	107/10/17	15,726	0.03	-	-	-	-	朝陽科技大學財務金融系學士 金益鼎企業(股)公司財會副理	台灣芯電應用科技(股)公司監察 人 創視媒體科技(股)公司監察人	無	無	無	-
稽核室 經理	中華民國	李旻諭	女	107/7/23	6,495	0.01	-	-	-	-	文化大學國際企業管理研究所碩士 盈盛科技(股)公司財務長 金居開發(股)公司稽核主管	-	無	無	無	-

註1：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：

本公司董事長兼任總經理，係為提升經營效率與決策執行力，惟為強化董事會之獨立性，公司內部已積極培訓合適人選；此外，董事長平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況與計劃方針以落實公司治理，未來本公司亦擬規劃增加獨立董事席次之方式提升董事會職能及強化監督功能。目前本公司已有下列具體措施：

1. 現任三席獨立董事分別在財務會計與半導體產業領域學有專精，能有效發揮其監督職能。
2. 每年度安排各董事參加證基會等外部機構專業董事課程，以增進董事會之運作效能。
3. 獨立董事在各功能性委員會皆可充分討論並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。
4. 董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人。

二、最近年度支付董事（含獨立董事）、總經理及副總經理之酬金

（一）一般董事及獨立董事之酬金：

單位：新台幣仟元；%

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金		
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(%)				
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司			
一般董事	陳亞理	-	-	-	5,065	208	288	6,567	108	607	-	12,555/9.57%	13,528/8.75%	無
	張惟傑	-	-	-	5,065	208	288	6,567	108	607	-	12,555/9.57%	13,528/8.75%	
	王起明	-	-	-	5,065	208	288	6,567	108	607	-	12,555/9.57%	13,528/8.75%	
	姜守危	-	-	-	5,065	208	288	6,567	108	607	-	12,555/9.57%	13,528/8.75%	
獨立董事	李慶超	828	-	-	-	152	152	-	-	-	-	980/0.75%	980/0.63%	無
	黃健騰	828	-	-	-	152	152	-	-	-	-	980/0.75%	980/0.63%	
	張木田	828	-	-	-	152	152	-	-	-	-	980/0.75%	980/0.63%	

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；本公司獨立董事之酬金，應於公司章程經依股東會決議訂之，並得酌訂與一般董事及監察人不同之合理酬金。該獨立董事之酬金亦得經相關法定程序酌定為月支之固定酬金，而不參與公司之盈餘分派。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司獨立董事之酬金，應於公司章程依股東會決議訂之，並得酌訂與一般董事及監察人不同之合理酬金。該獨立董事之酬金亦得經相關法定程序酌定為月支之固定酬金，而不參與公司之盈餘分派。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元	王起明 姜守危 李慶超 黃健騰 張木田	王起明 姜守危 李慶超 黃健騰 張木田	姜守危 李慶超 黃健騰 張木田	姜守危 李慶超 黃健騰 張木田
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	張惟傑	張惟傑	張惟傑	張惟傑
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	陳亞理	陳亞理	王起明	-
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	-	-	-	王起明
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	-	-	陳亞理	陳亞理
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	-	-	-	-
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	-	-	-	-
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	-	-	-	-
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	-	-	-	-
100,000,000元以上	-	-	-	-
總計	7	7	7	7

(二)總經理及副總經理之酬金：

單位：新台幣仟元：％

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	現金金額	股票金額	財務報告內所有公司股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
總經理	陳亞理	5,412	5,412	108	108	1,155	2,048	607	607	-	-	7,282 /5.55%	8,175 /5.29%	無
副總經理	王起明													

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元	-	-
1,000,000元(含)～2,000,000元(不含)	-	-
2,000,000元(含)～3,500,000元(不含)	王起明	王起明
3,500,000元(含)～5,000,000元(不含)	陳亞理	陳亞理
5,000,000元(含)～10,000,000元(不含)	-	-
10,000,000元(含)～15,000,000元(不含)	-	-
15,000,000元(含)～30,000,000元(不含)	-	-
30,000,000元(含)～50,000,000元(不含)	-	-
50,000,000元(含)～100,000,000元(不含)	-	-
100,000,000元以上	-	-
總計	2	2

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

113年12月31日 單位：新台幣仟元；%

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益比例(%)
經理人	總經理	陳亞理	-	1,472	1,472	1.12
	副總經理	王起明				
	行政支援處處長	張永宏				
	研發處處長	馮祥鉸				
	品質處處長	林峯葦				
	財務部經理	李妍蓉				
	會計部經理	鄭雅玲				
	稽核室經理	李旻諭				

(四)分別比較說明本公司及合併報告所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性

1. 最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金占稅後純益比例之分析

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	112 年度 酬金總額占稅後純益比例(%)		113 年度 酬金總額占稅後純益比例(%)	
	本公司	合併報表	本公司	合併報表
董事	5.00%	4.65%	4.77%	4.09%
總經理及副總經理	7.09%	7.34%	5.55%	5.29%

2. 本公司給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

(1)給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序

A.董事

本公司給付董事之酬金政策係訂於公司章程，並經股東會通過。本公司董事執行本公司職務時，其報酬授權董事會參酌國內外業界之水準議定之。如公司年度決算有盈餘時，依公司章程之規定分配酬勞。

B.總經理及副總經理

本公司總經理及副總經理之酬金包括薪資、獎金及員工酬勞，本公司給付酬金之政策，係依其學歷、經歷、參考同業薪資水準，並評估於公司職務之權責及貢獻度及公司經營成果，給予合理之報酬，應足以表彰其所承擔的責任及風險。

(2)與經營績效及未來風險之關聯性

本公司除考量營運目標、經營成果及財務狀況外，亦衡量個人績效達成情形及對公司績效之貢獻度，並綜合分析未來營運狀況。本公司薪資報酬委員會隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀求公司永續經營之發展與風險控管。

三、公司治理運作情形：

(一)董事會運作情形：

1. 董事會運作情形

最近年度（113 年度）董事會開會 6 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數	委託出席 次數	實際出(列) 席率(%)	備註
董事長	陳亞理	6	0	100	應出席：6 次，連任，改選日期:111/06/29
董事	張惟傑	6	0	100	應出席：6 次，連任，改選日期:111/06/29
董事	王起明	6	0	100	應出席：6 次，連任，改選日期:111/06/29
董事	姜守危	6	0	100	應出席：6 次，連任，改選日期:111/06/29
獨立董事	李慶超	6	0	100	應出席：6 次，連任，改選日期:111/06/29
獨立董事	黃健騰	6	0	100	應出席：6 次，連任，改選日期:111/06/29
獨立董事	張木田	6	0	100	應出席：6 次，連任，改選日期:111/06/29

其他應記載事項：

一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

113 年度及截至年報刊印日止董事會議決事項，所有獨立董事對於證交法第 14 條之 3 所列事項均無異議照案通過。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

日期/期別	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
113.08.08 第五屆 第十三次董事會	陳亞理 王起明	本公司發放 112 年度高 階經理人員工酬勞案。	因一般董事有自身利益 關係進行迴避及兼任本 公司經理人職務	依法迴避未參 與討論及表決
113.08.08 第五屆 第十三次董事會	陳亞理 王起明 張惟傑 姜守危	本公司發放 112 年度董 事酬勞分派案。	因一般董事有自身利益 關係進行迴避	依法迴避未參 與討論及表決
113.12.26 第五屆 第十六次董事會	陳亞理 王起明	本公司發放 113 年度高 階經理人年終獎金案	因一般董事利益迴避及 兼任本公司經理人職務	依法迴避未參 與討論及表決

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估範圍	評估方式	評估期間	評估內容及結果
每年執行一次	個別董事成員	董事成員自評	113.01.01 ~ 113.12.31	公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業與持續進修、內部控制 1.各構面平均分數:4.93 分 / 滿分 5 分 2.本公司董事會整體運作情況尚屬完善，符合公司治理。
每年執行一次	整體董事會	董事會內部自評	113.01.01 ~ 113.12.31	公司營運之參與程度、決策品質、組成與結構、選任及持續進修、內部控制 1.各構面平均分數:4.89 分 / 滿分 5 分。 2.本公司董事會整體運作情況尚屬完善，符合公司治理。
每年執行一次	審計委員會	審計委員會內部自評	113.01.01 ~ 113.12.31	對公司營運之參與程度、職責認知、決策品質、組成及成員選任、內部控制 1.各構面平均分數:5.00 分 / 滿分 5 分。 2.本公司審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理。
每年執行一次	薪資報酬委員會	薪資報酬委員會內部自評	113.01.01 ~ 113.12.31	對公司營運之參與程度、職責認知、決策品質、組成及成員選任、內部控制 1.各構面平均分數:5.00 分 / 滿分 5 分。 2.本公司薪資報酬委員會整體運作情況完善，符合公司治理。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

- 1.本公司已依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定「董事會議事規則」以茲遵循，注重營運透明及股東權益，於董事會後依法將重大議案公告於公開資訊觀測站。
- 2.本公司已設置審計委員會及薪資報酬委員會，分別協助董事會履行其監督職責。

(二)審計委員會運作情形

1. 審計委員會運作情形

最近年度（113 年度）審計委員會開會 6 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列) 席次數	委託出席 次數	實際出席(列) 席率(%)	備註
獨立董事	李慶超	6	0	100	應出席：6 次，連任，改選日期：111/06/29
獨立董事	黃健騰	6	0	100	應出席：6 次，連任，改選日期：111/06/29
獨立董事	張木田	6	0	100	應出席：6 次，連任，改選日期：111/06/29

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

審計委員會	議案內容	審計委員會 決議結果	董事會	公司對審計 委員會意見 之處理
113.3.8 第二屆第十次	擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。	全體出席獨立董事同意通過。	113.3.8 第五屆第十一次	無

	擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	全體出席獨立董事同意通過。		無
	本公司 112 年度『內部控制制度聲明書』。	全體出席獨立董事同意通過。		無
	審核 112 年度個體財務報表暨合併財務報表。	全體出席獨立董事同意通過。		無
113.5.3 第二屆第十一次	擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文案。	全體出席獨立董事同意通過。	113.5.3 第五屆第十二次	無
	擬修訂本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」部份條	全體出席獨立董事同意通過。		無
	113 年第一季合併財務報表。	全體出席獨立董事同意通過。		無
113.8.8 第二屆第十二次	113 年第二季合併財務報表。	全體出席獨立董事同意通過。	113.8.8 第五屆第十三次	無
	修訂核決權限-文件管制程序	全體出席獨立董事同意通過。		無
113.10.17 第二屆第十三次	擬修訂本公司「合約訂定及審查管理辦法」部分條文案。	全體出席獨立董事同意通過。	113.10.17 第五屆第十四次	無
	擬投資新設公司案。	全體出席獨立董事同意通過。		無
	擬投資三廠 C4F6 一級製造廠建廠案。	全體出席獨立董事同意通過。		無
113.11.11 第二屆第十四次	擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。	全體出席獨立董事同意通過。	113.11.11 第五屆第十五次	無
	113 年第三季合併財務報表。	全體出席獨立董事同意通過。		無
113.12.26 第二屆第十五次	修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人財務、業務往來	全體出席獨立董事同意通過。	113.12.26 第五屆第十六次	無
	修訂本公司「審計委員會組織規程」。	全體出席獨立董事同意通過。		無
	修訂本公司「防範內線交易管理辦法」。	全體出席獨立董事同意通過。		無
	訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」。	全體出席獨立董事同意通過。		無
	訂定本公司「永續發展委員會組織規程」。	全體出席獨立董事同意通過。		無

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）。

(一)獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：

日期	溝通重點	審計委員會建議	公司執行或回覆
113.03.08	一、法令規定事項執行與申報情形報告。 二、112 年度稽核計畫執行與稽核缺失改善狀況說明。 三、內部控制制度設計及執行有效性項目討論。 四、覆核 112 年『內部控制制度自行評估情形』及內控聲明書內容討論。	本次會議無補充建議	無
113.05.03	一、法令規定事項執行與申報情形報告。 二、112 年度稽核缺失改善狀況報告與討論。 三、113 年度 1-3 月稽核計畫執行情形報告。	本次會議無補充建議	無
113.08.08	一、法令規定事項執行與申報情形報告。 二、113 年 4-6 月稽核發現及改善情形追蹤彙報。	本次會議無補充建議	無
113.10.17	一、『永續資訊管理』內控制度內容建議與討論。 二、就『永續發展治理架構、永續資訊涵蓋內容、重大主題、指標…等』議題進行討論。	委員會建議應成立永續發展委員會專責單位控管	擬於 113 年 12 月提請董事會決議，設置永續發展委員會專責單位
113.11.11	一、報告 113 年度 7-10 月稽核計畫執行情形。	本次會議無補充建議	無
113.12.26	一、報告 113 年度 10-11 月稽核計畫執行情形。 二、報告 113 年度風險管理執行情形。 三、討論編制 114 年稽核計畫之風險評估事項與稽核計畫項目。	本次會議無補充建議	無

(二)獨立董事與會計師之溝通情形：

本公司簽證會計師除針對財務報告之查核或核閱情形向獨立董事報告，當有最新之財稅法令新知也會傳達，平時獨立董事與會計師間得視需要以電子郵件、書函、電話或會面方式相互聯繫，本公司獨立董事與會計師溝通情形良好，最近年度截至年報刊印日止獨立董事與會計師之溝通情形摘述如下：

日期	溝通管道	溝通重點	建議及結果
113.03.08	審計委員會	1.會計師就 112 年財務報告查核結果進行說明，並與獨立董事溝通。	無異議
113.08.08	審計委員會	1.會計師就 113 年第二季財務報告核閱結論進行說明，並與獨立董事溝通。 2.年度查核(核閱)規劃。	無異議
114.03.06	審計委員會	1.會計師就 113 年財務報告查核結果進行說明，並與獨立董事溝通。	無異議

四、本公司審計委員會年度主要工作及重點彙整如下：

- (一) 訂定或修正內部控制制度。
- (二) 內部控制制度有效性之考核。
- (三) 訂定或修正重要管理辦法或作業程序。
- (四) 涉及董事自身利害關係之事項。
- (五) 重大之資產或衍生性商品交易。
- (六) 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (七) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (八) 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (九) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (十) 財務報告。

審核財務報告

董事會造具本公司 113 度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合。

考核內部控制制度有效性

內部控制制度設計及執行有效性經由各單位自行評估，由稽核單位覆核，並由審計委員會審核有效。

委任簽證會計師之評估

為確保簽證會計師事務所的獨立性，審計委員會係參照會計師法及會計師職業道德規範之「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定獨立性評估表，就會計師之獨立性、專業性及適任性評估，評估是否與本公司互為關係人、互有業務或財務利益關係等，並於 114 年 3 月 6 日審計委員會決議。

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已參照「上市上櫃公司治理實務守則」訂定晶科科技股份有限公司「公司治理實務守則」。 本公司除遵守法令及章程之規定外，已建置有效之公司治理架構，保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、尊重利害關係人權益、提昇資訊透明度。
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		(一)本公司已建立發言人與代理發言人制度，對外處理股東建議等事項，並遵守資訊公開之規定，定期於公開資訊觀測站中揭露公司財務、業務資訊予股東參考。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		(二)本公司由專業的股務代理機構負責，並設置專責人員隨時掌握重要股東(董事、經理人及持股百分之五以上之大股東)持股情形。
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		(三)本公司與各關係企業之財務、業務均各自獨立運作。並訂有「對子公司監督及管理作業」，且依本公司內部控制制度辦理，確實執行風險控管及防火牆機制。
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		(四)本公司訂定『內部重大資訊處理作業程序』、『防範內線交易管理辦法』規範並宣導內部人員知悉。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓	(一) 1. 本公司現任董事會由 7 位董事組成，其中包含 4 位一般董事及 3 位獨立董事，成員具備財經、商務及管理領域之豐富經驗與專業，以及危機處理能力及宏觀的國際市場觀，其全面性的考量以及豐富的產業知識，相信能為公司發展及營運帶來極大助益。 2. 董事會成員多元化落實情形請參閱本年報第 5-6 頁，以及擬訂多元化之政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站。	無重大差異
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	✓	(二) 本公司依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，並已於 110 年 9 月 16 日設置提名委員會、111 年 11 月 9 日設置風險管理委員會及 113 年 12 月 26 日設置永續發展委員會。其餘公司治理運作均由各部門依其職掌負責，未來將視需要評估設置。	無重大差異
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名聘任之參考？	✓	(三) 本公司已訂定『董事會績效評估辦法』並每年執行一次董事會績效評估，評估方式包括董事會內部自評、董事會自評、功能性委員會內部自評。	無重大差異
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓	(四) 本公司審計委員會每年對簽證會計師評估其獨立性及適任性。	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會議事錄等)?	✓		本公司經 112 年 5 月 10 日董事會決議通過，依「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」之規定，任命行政支援處張永宏處長擔任公司治理主管。主要職責為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄之相關事宜、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、向董事會報告獨立董事資格是否符合相關法令規章之檢視結果。本公司公司治理主管資格符合「上市上櫃公司治理實務守則」公司治理主管規定，並依法令規定完成專業進修。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	✓		無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	✓		無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
七、資訊公開			
(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		(一) 本公司已架設網站揭露財務業務及公司治理資訊之情形。
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	✓		(二) 本公司已指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，並依規定落實發言人制度。 本公司法人說明會相關開會資料已依規定放置於本公司網站及揭露於公開資訊觀測站。
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓		(三) 本公司目前皆依『公開發行公司應公告或向本會申報事項一覽表』規定，於會計年度終了後3個月內公告並申報年度財務報告，113年年度財務報告已於114年3月6日公告，第一、二、三季財務報告與各月份營運情形亦皆於規定期限內完成公告並申報。 本公司擬將會計年度終了後兩個月內，公告並申報年度財務報告定為中長期精進之目標。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事購買責任保險之情形等）？	✓	本公司秉持穩健及永續經營之理念，和員工分享利潤，對員工福利及教育訓練極為重視，招募員工時未限制性別、宗教、種族或政治立場，透過公開招募的方式，用人唯才；對於員工權益之保障係依勞基法及相關法律之規定徹底執行，亦以高標準監督工作環境的衛生與安全。勞資關係之一切規定措施，均依相關法令辦理。 投資者關係： 本公司由專人負責處理股東建議事項。 供應商關係： 本公司亦與供應商關係良好，確守誠信原則執行業務，以維持成本與供貨的穩定。 利害關係人： 本公司秉持著誠信原則及永續經營的理念，與客戶、供應商及其他利害關係人共同合作、互惠互利，並期望為股東及員工創造長久穩定的利益。 董事及獨立董事進修情形： 本公司董事及獨立董事均具有產業專業資歷或財經相關專業經驗。公司亦每年為董事及獨立董事安排持續進修公司治理相關課程。	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
		摘要說明 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司於 111 年 11 月 9 日設置風險管理委員會，依照整體營運方針擬定風險管理政策、風險管理組織規程，並經董事會核准。 本公司風險來源與類別構面包含策略風險、營運風險、財務風險、資訊風險、法遵風險、誠信風險、其他新興風險(如：氣候變遷或傳染病相關風險)等。 風險管理委員會運作情形 ● 113 年 11 月 11 日召開第四次風險管理委員會報告風險管控事項執行情形。 盤點辨識之主要風險。 客戶政策之執行情形： 本公司與客戶秉持公平、尊重、誠信之道德行為準則，與客戶維持穩定良好關係。 公司為董事購買責任保險之情形： 本公司已為董事及獨立董事投保責任保險。	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：	第十一屆公司治理評鑑：本公司列為上櫃公司 51%-65%，將針對尚未得分項目，持續配合主管機關政策之推動及評估考量可改善之措施，提升公司治理成效。		

民國 113 年度董事進修情形：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
董事	陳亞理	2024.11.06	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業舞弊之調查實務與案例解析	6.0	6.0
董事	張惟傑	2024.03.08	中華民國內部稽核協會	營運系統稽核之聚焦與跨循環及作業之整合	6.0	6.0
董事	王起明	2024.09.11	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 新竹場	3.0	6.0
		2024.12.13	社團法人中華公司治理協會	公司治理人員制度介紹及法務人員在公司治理的角色	3.0	
董事	姜守危	2024.12.03	中華民國內部稽核協會	從公司治理看薪工循環與勞動事件法	6.0	6.0
獨立董事	李慶超	2024.09.06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3.0	6.0
		2024.10.07	中華民國工商協進會	2024 台新淨零高峰論壇	3.0	
獨立董事	黃健騰	2024.10.18	中華民國內部稽核協會	企業執行「ESG」與「內稽內控整合」應用與範例	6.0	6.0
獨立董事	張木田	2024.06.17	中華民國內部稽核協會	如何調整內控制度以因應 ESG 之新規範	6.0	12.0
		2024.06.25	中華民國內部稽核協會	提升企業永續價值，完善風險管理制度	6.0	

(四)公司設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

身分別	姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事	李慶超 (註1)	參閱第9頁董事資料 相關內容說明。	依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，且為健全董事會功能及強化管理機制，本公司於民國110年9月16日設置提名委員會，本委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中有過半數獨立董事參與。本公司於董事會成員之提名與遴選時，已獲得每位董事的書面聲明、工作經歷、目前在職證明，以及提供之親屬關係表以予核實，已確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性；且另經核實左列三位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	2
獨立董事	黃健騰			0
獨立董事	張木田			0

註1：為薪資報酬委員會召集人。

2.薪資報酬委員會之職責

訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，以及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

3.薪資報酬委員會運作情形資訊：

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員任期：111 年 06 月 29 日至 114 年 6 月 28 日，最近年度（113 年度）薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率%(B/A)	備註
召集人	李慶超	3	0	100%	應出席：3 次，連任，改選日期:111/06/29
委員	黃健騰	3	0	100%	應出席：3 次，連任，改選日期: 111/06/29
委員	張木田	3	0	100%	應出席：3 次，連任，改選日期: 111/06/29

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：董事會皆採納薪資報酬委員會之建議，無不同意見。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：薪資報酬委員會成員經充分討論後，做出一致性決議，無成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之情形。

三、薪資報酬委員會最近一年議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：

薪資報酬委員會	議案內容	薪資報酬委員會決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113.3.8 第二屆 第六次	112 年度員工酬勞及董監酬勞分派案 審查本公司董事會績效評估結果	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過
113.8.8 第二屆 第七次	審查本公司發放 112 年度高階經理人員工酬勞案 審查本公司發放 112 年度董事酬勞分派案	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過
113.12.26 第二屆 第八次	審查本公司發放 113 年度高階經理人年終獎金金額	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		本公司於113年12月26日成立永續發展委員會，由總經理室為專(兼)職單位，主要負責強化永續治理即實踐永續發展目標，必要時向董事會報告處理情形。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		本公司於110年9月16日董事會通過『風險管理政策與程序』，並於111年11月9日設置風險管理委員會，訂定明確組織功能與職責分工。 本公司每年依照整體營運方針定義各類風險，建立及早辨識、準確衡量、有效監督及嚴格控管項目。 112年依重大性原則將風險依環境、社會、公司治理與其他等面向區分為：環境風險、地緣風險、營運風險、投資風險、法律合規風險、作業危害風險、與其他風險。 本公司有針對所製造之產品，投保相關產品責任險，以達到： 1.降低本公司營運風險。 2.降低客戶品質不相符責任風險。 本公司建立全台灣最安全之特殊氣體倉庫，其中24小時洩漏氣體之監控，

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			與自動抽氣廢氣處理系統，是安全係數最高的倉庫，足以降低營運風險。本公司採逐步建立企業風險管理系統(ERM)，旨在可承受之風險範圍內，預防可能的損失，依據內外環境變化，持續調整改善最佳風險管理實務，以保護員工、股東、合作夥伴與顧客的利益，增加公司價值，並達成公司資源配置之最佳化原則。
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		無重大差異
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	✓		(三)本公司於111年11月9日設置風險管理委員會，並於113年12月26日成立永續發展委員會，依照整體營運方針擬定風險管理政策，對於氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，列入風險評估及控制作業，以降低風險並發掘公司業務發展機會。	無重大差異
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		(四)本公司有統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並公告於公司網站ESG專區。本公司為落實保護環境，除不定期宣導力行節約用水、垃圾減量、環保節能等措施，於用水、用電處所貼標語，提醒節約能源，以實際行動展現對環境保護的決心。	無重大差異
四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		(一)本公司於「工作規則」中明訂相關人權之管理規範。對於求職者或受雇者之招募、甄試、晉用、分發、配置、考績或升遷等，不因種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、	無重大差異

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙或以往工會會員身分為由，予以歧視，而有差別待遇。
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		(二)本公司每年舉辦員工旅遊，且每位員工都可攜帶眷屬一起參加。本公司每年依據公司營運狀況及員工績效，核發績效獎金。本公司設置休閒保健設施，例如全身音波垂直律動儀、運動舒壓椅、血壓計、撞球、乒乓球等，免費讓員工使用，照顧員工健康。
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		(三)本公司建置最高規格消防設施，定期安檢，確保廠區人員與設施受安全防護。倉庫設有災害隔離系統，阻絕災害蔓延。每年舉辦消防安全講習兩次，規定全體員工參加。每位員工每年一次接受健康諮詢，追蹤身體健康狀況。於廠區設置多座AED（自動體外心臟電擊去顫器），以備不時之需。
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培	✓		(四)本公司針對員工工作特性，為員工

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
訓計畫？ (五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際標準，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？ (六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓	工安排相關專業之教育訓練，提升員工工作能力外，也可以持續強化公司之競爭力。 (五)本公司特殊氣體相關產品之標示，皆按照政府相關法規及國際標準，危險發生時可以馬上有所對應處理程序，降低危害擴大的風險。本公司有制定相關保護消費者權益政策及申訴程序之程序書，確保客戶權益。 (六)本公司因應 ISO9001 之規範，都有相關供應商評鑑等管理辦法，供應商評鑑與管理辦法當中，都有詳載相關環保、職業安全衛生與勞動人權等規範，並按照規範實施之。	無重大差異 無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓	本公司已編製永續報告書，並取得第三方驗證單位之確信報告。	無重大差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之企業社會責任守則，實際運作情形與守則無差異。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：已於前述運作情形說明。			

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		(一)公司已於108年2月26日訂定【誠信經營守則】及【董事及經理人道德行為準則】，並經董事會通過，於109年3月20日訂定【誠信經營作業程序及行為指南】並經董事會通過，積極落實誠信經營。 為防範不誠信行為，就具較高不誠信行為風險之營業活動，依不誠信行為風險評估結果擬定稽核計畫，確實執行稽核；對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制；『工作規則』第27條規定員工不得因職務上之行為或違背職務上之行為，接受招待、饋禮、回扣或其他不法利益。 為讓集團內所有人確實了解並執行誠信經營政策，定期執行教育訓練及要求所有人簽署『恪遵誠信經營政策承諾書』。
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業	✓		(二)本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」，針對不誠信行為(包括「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為)之防範及事後處理

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？		進行規範，各級主管亦重視誠信行為之宣導。	
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓	(三)公司經由相關內控制度之落實，及制訂與執行「誠信經營守則」、「道德行為準則」，已能將不誠信行為之風險降至最低。	符合誠信經營守則規範
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓	(一)公司對外執行商業活動皆以誠信守法為基本原則，在與合作廠商簽訂合約時，皆會要求誠信合作並遵循相關法令。	符合誠信經營守則規範
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓	(二)本公司已設置專責單位推動企業誠信經營事宜。本公司一年一次向董事會報告誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形。最近一次於113年12月26日向董事會報告執行狀況。 113年本公司集團之董事、監察人、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力	符合誠信經營守則規範

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當管道，並落實執行？	✓		者，於從事商業行為之過程中，未發現有違反誠信、不法或違背託義義務等不誠信之行為。未來也將持續以最高誠信標準進行自我要求。 (三) 本公司董事會議事規則第十五條規定，明訂董事之利益衝突迴避政策，董事對於會議事項，應於當其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使表決權。 本公司亦制定「董事及經理人道德行為準則」及「道德行為準則」規範董事、經理人及全體員工共同遵循，並要求經理人及受雇人於從事商業行為之過程中，不得直接或間接收取任何不正當之利益，或為不正當之承諾。 符合誠信經營守則規範
	✓		(四) 公司已建立有效之會計制度、內部控制制度，並經常依據法令變動及實務需求隨時檢討、修訂。 公司內部稽核單位，每年皆依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，定期查核防範不誠信行為方案之遵循情形。 符合誠信經營守則規範

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
情形，或委託會計師執行 查核？			
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五)定期向公司集團內所有人員進行教育訓練及宣導「誠信經營守則」，新進人員於新人教育訓練時宣導及要求遵循誠信經營政策。
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		(一)本公司已制定「檢舉制度辦法」及提供檢舉信箱供公司內外人員使用，對被檢舉對象指派適當之受理專責人員。
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		(二)本公司於「檢舉制度辦法」訂有檢舉處理程序、檢舉人之保護及相關保密機制。
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		(三)本公司於「檢舉制度辦法」已訂檢舉人之保護制度，避免檢舉人因檢舉而遭受不當處置。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信	✓		本公司已於公司網站及公開資訊觀測站揭露誠信經營守則內容及推動成效。
			符合誠信經營守則規範

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
經營守則內容及推動成效？				
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司已訂定誠信經營守則，符合誠信經營守則規範情形。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、其他商業行為相關法令，本著不違背誠信原則經營公司各項事務。				

(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：

本公司於 113 年 11 月 11 日修訂「公司治理實務守則」並經董事會決議通過，公司之運作均遵循「上市上櫃公司治理實務守則」相關之規定辦理，針對本公司適用公司治理守則訂定之相關規章辦法，可至公司網站及公開資訊觀測站查詢。

(八)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：本公司對於重大訊息即時揭露，並依規定輸入公開資訊觀測站。

(九)內部控制制度執行狀況：

1.內部控制聲明書：請參閱公開資訊觀測站。查閱路徑如下：

公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告
(<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>)

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰，或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形：無。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1.股東會重要決議：

本公司 113 年股東常會於 113 年 6 月 19 日在苗栗舉行。會中出席股東決議通過事項如下：

A.承認 112 年度營業報告書及財務報表案：決議通過。

B.承認 112 年度盈餘分派案：決議通過。

每股分配現金股利 2.0 元，訂定 113 年 9 月 1 日為除權(息)基準日，並於 113 年 9 月 30 日發放現金股利。

C.辦理資本公積發放現金案：決議通過。

每股分配現金 1.5 元，訂定 113 年 9 月 1 日為除權(息)基準日，並於 113 年 9 月 30 日發放現金。

D.112 年度盈餘轉增資發行新股案：決議通過。

每股分配股票股利 0.5 元，訂定 113 年 9 月 1 日為除權(息)基準日，113 年 9 月 30 日為股票發放日。

2.董事會重要決議：

日期	董事會 屆次	重要決議事項
113/03/08	第五屆 第十一次 董事會	1.擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
		2.擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
		3.本公司 112 年度『內部控制制度聲明書』。
		4.本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
		5.審核 112 年度個體財務報表暨合併財務報表。
		6.本公司 112 年度盈餘分派案。
		7.辦理資本公積發放現金案。
		8.本公司簽證會計師之委任暨其獨立性及適任性評估。
		9.112 年度盈餘轉增資發行新股案。
		10.本公司向兆豐國際商業銀行借款額度申請。
		11.本公司向兆豐國際商業銀行長期擔保放款額度(購置廠辦)申請。

日期	董事會 屆次	重要決議事項
		12. 擬請召集本公司 113 年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。
113/05/03	第五屆 第十二次 董事會	1. 擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文案。
		2. 擬修訂本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」部份條文案。
		3. 本公司 113 年第一季合併財務報表。
		4. 本公司 2024 年銀行借款額度申請。
113/08/08	第五屆 第十三次 董事會	1. 本公司 113 年第二季合併財務報表。
		2. 本公司 2024 年銀行借款額度申請。
		3. 112 年度盈餘轉增資發行新股、除權(息)基準日相關事宜。
		4. 本公司發放 112 年度高階經理人員工酬勞案。
		5. 本公司發放 112 年度董事酬勞分派案。
		6. 本公司已完成 112 年度永續報告書。
		7. 修訂核決權限-文件管制程序。
113/10/17	第五屆 第十四次 董事會	1. 擬修訂本公司「合約訂定及審查管理辦法」部分條文案。
		2. 本公司擬投資新設公司案。
		3. 本公司擬投資三廠 C4F6 一級製造廠建廠案。
113/11/11	第五屆 第十五次 董事會	1. 擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
		2. 本公司 113 年第三季合併財務報表。
113/12/26	第五屆 第十六次 董事會	1. 修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人財務、業務往來作業辦法」。
		2. 修訂本公司「審計委員會組織規程」。
		3. 修訂本公司「防範內線交易管理辦法」。
		4. 訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」。
		5. 訂定本公司「永續發展委員會組織規程」。
		6. 設置永續發展委員會暨委任永續發展委員會成員。
		7. 本公司 114 年年度稽核計畫已擬定。
		8. 本公司 2025 年經營方針計劃暨預算案。
		9. 擬對本公司之轉投資事業提供背書保證事宜。
		10. 本公司發放 113 年度高階經理人年終獎金案。
		11. 為落實公司治理，本公司擬為全體董事於任期內投保「董監事責任險」。
114/03/06	第五屆 第十七次	1. 本公司 113 年永續報告書之重大主題。
		2. 核定本公司委任第三方機構執行永續報告書獨立確信或查證案。

日期	董事會 屆次	重要決議事項
	董事會	3. 修訂本公司「公司章程」案。
		4. 本公司 113 年度『內部控制制度聲明書』。
		5. 本公司向子公司取得(處分)供營業使用之資產交易案。
		6. 本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
		7. 審核 113 年度個體財務報表暨合併財務報表。
		8. 本公司 113 年度盈餘分派案。
		9. 辦理資本公積發放現金案。
		10. 本公司簽證會計師之委任暨其獨立性及適任性評估。
		11. 113 年度盈餘轉增資發行新股案。
		12. 三廠融資案。
		13. 改選董事(含獨立董事)案。
		14. 受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所。
		15. 本公司董事會提名第六屆董事(含獨立董事)候選人案。
		16. 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
		17. 擬請召集本公司 114 年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。

(十二)最近年度及截至年報刊印日止，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無此情形。

(十三)最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：無此情形。

四、簽證會計師公費資訊：

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	于智帆	113.01.01~ 113.12.31	3,740	604	4,344	非審計公費包含永續報告書之確信服務及盈餘轉增資發行新股等。
	黃世鈞					

(一)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情形。

(二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

五、更換會計師資訊：無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無此情形。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形：

單位：股

職稱	姓名	113 年度		114 年 1 月 1 日至 3 月 29 日	
		持有股數增 (減) 數	質押股數增 (減) 數	持有股數增 (減) 數	質押股數增 (減) 數
百分之十以上股東 董事長兼總經理	陳亞理	219,540	-	-	-
董事	張惟傑	49,783	-	-	-
董事兼副總經理	王起明	412	-	5,000	-
董事	姜守危	4,992	-	-	-
獨立董事	李慶超	-	-	-	-
獨立董事	黃健騰	-	-	-	-
獨立董事	張木田	-	-	-	-
處長	張永宏	(36,645)	-	-	-
處長	馮祥鉸	3,613	-	-	-
處長	林峯華	-	-	-	-
經理	李妍蓉	(4,450)	-	-	-
經理	鄭雅玲	(2,252)	-	-	-
經理	李旻諭	(7,530)	-	8,000	-

(二)股權移轉之相對人為關係人者：無。

(三)股權質押之相對人為關係人者：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

114 年 03 月 29 日；單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
陳亞理	5,660,341	12.52%	-	-	504,409	1.12%			-
國泰人壽全權委託國泰投信投資帳戶（台股十五）	3,012,524	6.66%	-	-	-	-			-
郭淑齡	1,201,059	2.66%	-	-	-	-			-
張惟傑	1,045,444	2.31%	-	-	-	-	張坤祥 張惟森	父子 兄弟	-
張坤祥	909,255	2.01%	-	-	-	-	張惟傑 張惟森	父子	-
張惟森	771,750	1.71%	-	-	-	-	張坤祥 張惟傑	父子 兄弟	-
張登凱	760,159	1.68%	-	-	-	-			-
張永宏	670,474	1.48%	180,501	0.40%	-	-			-
詹偉明	664,204	1.47%	-	-	-	-			-
湯文萬	592,000	1.31%	-	-	-	-			-

九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：

113 年 12 月 31 日；單位：仟股

轉投資事業	本公司投資		董事、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
南京晶咏呈新材料有限公司	不適用(註)	100%	-	-	不適用(註)	100%
亞欣達特殊材料(股)公司	3,897	50%	-	-	3,897	50%
台灣芯電應用科技(股)公司	3,500	70%	-	-	3,500	70%
創視媒體科技(股)公司	1,800	60%	-	-	1,800	60%

註：非股份有限公司且未發行股票。

參、募資情形

一、資本及股份：

(一)股本來源：

114 年 03 月 29 日；單位：仟股；新台幣仟元

年 月	發 行 價 格 (元)	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股 本 來 源	以 現 金 以 外 之 財 產 抵 充 股 款 者	其 他
99 年 12 月	10	10,000	100,000	3,000	30,000	設立資本 30,000 仟元	無	99.12.16 經授中字第 09932974610 號
101 年 04 月	10	32,000	320,000	14,400	144,000	現金增資 114,000 仟元	無	101.4.18 經授中字第 10131901650 號
103 年 06 月	10	32,000	320,000	16,800	168,000	現金增資 24,000 仟元	無	103.7.15 經授中字第 10333500330 號
104 年 08 月	10	32,000	320,000	18,480	184,800	盈餘轉增資 16,800 仟元	無	104.9.18 經授中字第 10433752250 號
105 年 07 月	10	32,000	320,000	19,958	199,584	盈餘轉增資 14,784 仟元	無	105.8.23 經授中字第 10534279190 號
105 年 12 月	14	32,000	320,000	22,958	229,584	現金增資 30,000 仟元	無	106.1.17 經授中字第 10633033990 號
106 年 05 月	18	32,000	320,000	25,958	259,584	現金增資 30,000 仟元	無	106.5.25 經授中字第 10633295600 號
107 年 08 月	10	32,000	320,000	27,126	271,265	盈餘轉增資 11,681 仟元	無	107.8.30 經授中字第 10733511380 號
108 年 10 月	28	32,000	320,000	29,627	296,265	現金增資 25,000 仟元	無	108.10.18 經授中字第 10833642210 號
109 年 08 月	10	50,000	500,000	30,041	300,413	盈餘轉增資 4,147 仟元	無	109.8.24 經授中字第 10933476300 號
110 年 04 月	103	50,000	500,000	31,241	312,413	現金增資 12,000 仟元	無	110.4.09 經授中字第 11033199710 號
110 年 09 月	10	50,000	500,000	31,866	318,661	盈餘轉增資 6,248 仟元	無	110.9.14 經授中字第 11033570730 號
111 年 05 月	86.8	50,000	500,000	35,851	358,511	現金增資 39,850 仟元	無	111.5.03 經授中字第 11133267550 號
111 年 09 月	10	50,000	500,000	36,926	369,266	盈餘轉增資 10,755 仟元	無	111.9.07 經授中字第 11133556290 號
112 年 07 月	10	50,000	500,000	38,773	387,730	盈餘轉增資	無	112.7.27 經授中字第

年 月	發 行 價 格 (元)	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股 本 來 源	以 現 金 以 外 之 財 產 抵 充 股 款 者	其 他
						18,463 仟元		第 11233454080 號
112 年 12 月	130	50,000	500,000	43,073	430,730	現金增資 43,000 仟元	無	112.12.07 經授中字 第 11233736910 號
113 年 09 月	10	50,000	500,000	45,227	452,270	盈餘轉增資 21,536 仟元	無	113.9.09 經授商字 第 11330807020 號

1.股份種類：

114 年 03 月 29 日；單位：股

股份種類	核 定 股 本			備 註
	流 通 在 外 股 份	未 發 行 股 份	合 計	
普通股	45,226,638	4,773,362	50,000,000	上櫃股票

2.總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)主要股東名單：

114 年 03 月 29 日

主 要 股 東 名 稱	股 份	持 有 股 數	持 股 比 例
陳亞理		5,660,341	12.52%
國泰人壽全權委託國泰投信投資帳戶(台股十五)		3,012,524	6.66%
郭淑齡		1,201,059	2.66%
張惟傑		1,045,444	2.31%
張坤祥		909,255	2.01%
張惟森		771,750	1.71%
張登凱		760,159	1.68%
張永宏		670,474	1.48%
詹偉明		664,204	1.47%
湯文萬		592,000	1.31%

(三)公司股利政策及執行狀況：

1.公司章程所訂之股利政策：

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限，另視公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累計未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素。每年就可分配盈餘提撥股東股息紅利，盈餘分配之比率，得視實際獲利及資金狀況，以不低於可供分配盈餘百分之十分配，但經前述分配方式之每股紅利如低於 0.1 元時，得經董事會擬議不予分派，並提請股東會承認。股東股息紅利得以現金或股票方式發放，其中現金股利不得低於股利總額之百分之十。

2.本次股東會擬議股利分派之情形：

本公司 114/3/6 董事會決議 113 年度盈餘分派案擬配發股東現金股利新台幣 99,498,604 元，每股配發 2.2 元；股票股利新台幣 22,613,310 元，每股配發 0.5 元；並以超過面額發行普通股溢價之資本公積發放現金新台幣 81,407,948 元，每股配發 1.8 元。俟股東常會通過後，授權董事會另訂除權除息基準日。

3.預期股利政策有重大變動之說明：無此情形。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本公司未公開 114 年度財務預測，故無法揭露營業收入、損益及每股盈餘等之預測性資訊，因此本項目不適用。

(五)員工及董事酬勞：

1.公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司每年如有獲利，應提撥 2%以上為員工酬勞，及提撥 3%以下為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應先預留彌補虧損數額。員工酬勞得以現金或股票方式發放，其分派對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。董事酬勞之發放比率、員工酬勞之發放方式及比率，應由董事會決議並提股東會報告。

2.本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司員工及董監事酬勞以公司章程所訂之成數為基礎，並依此原則於各年度進行估列，經董事會決議通過提報股東會。如次年度股東會決議分配數與估列數有差異時，則視為會計估計變動，調整分配年度之損益。

3.董事會通過分派酬勞情形：

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額：

本公司 113 年度員工及董事酬勞分派案已於 114 年 3 月 6 日經董事會決議通過，擬分配予員工及董事之現金酬勞均為 5,065 仟元，董事會決議配發之金額與財務報告認列之金額並無差異。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本次無以股票分派之員工酬勞，故不適用。

4.前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

113 年度股東會通過自 112 年度可分配盈餘中分派員工酬勞 4,375 仟元及董事酬勞 4,375 仟元，實際配發員工酬勞及董事酬勞均為 4,375 仟元。實際配發情形與原認列數相同，並無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：

(一)計畫內容：

截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者，詳細說明其計畫內容：無。

(二)執行情形：

各次計畫用途，如執行進度或效益未達預計目標者，應具體說明其原因、對股東權益之影響及改進計畫：無。

肆、營運概況

一、業務內容：

(一)業務範圍：

1.所營業務之主要內容：

- (1)精密化學品之生產製造與銷售：透過乾式化學品精餾技術開發之商品，主要應用於半導體與平面顯示器等製程所需。
- (2)ReBirth/矽晶圓重生服務：透過氣態分解溶蝕技術開發之設備，主要提供半導體客戶之矽晶圓表面去除薄膜服務。
- (3)CMW/銅磁晶片及相關產品生產製造與銷售：透過導磁膜散熱技術開發之商品，主要應用於垂直結構 Mini 及 Micro LED 之顯示器製造。
- (4)特殊材料之銷售與代理：主要應用於半導體、平面顯示器、LED 及太陽能產業。
- (5)半導體級濕式化學品製造與銷售：去光阻液之製造與銷售。
- (6)玻璃通孔基板：使用精密雷射技術與氣相蝕刻，進行玻璃鑽孔的製造，提應用於半導體高階精密封裝。
- (7)精密設備暨零組件銷售與代理：主要應用於太陽能產業之設備及其零組件。

2.營業比重：

單位：新台幣仟元

年度 產品別	113 年度	
	營業收入淨額	營業比重(%)
精密化學品	969,268	95.32
特殊材料	13,392	1.32
精密設備暨零組件	11,145	1.09
勞務收入暨其他	23,055	2.27
合計	1,016,860	100.00

3.公司目前之產品及服務項目：

(1)精密化學品（特殊氣體）

產品包含 C₄F₈(八氟環丁烷)、SiF₄(四氟化矽)、C₃F₈(八氟丙烷)、C₄F₆(六氟丁二烯)、CH₂F₂(二氟甲烷)、F₂ mixture(氟混合氣)、SF₆(六氟化硫)、Xe(氙)、Kr(氪)、Neon(氖)、Neon Mixture(氖混合氣)等。

其中超高純度 C₄F₈(八氟環丁烷)已於 2018 年在竹南基地設廠在地化製造，並於 2018 年 8 月量產成功，2018 年 9 月正式開始供貨給各大半導體等電子產業，C₄F₆(六氟丁二烯)於晶呈一廠導入四級製造，於 2023 Q4 開始供貨給各大半導體廠。

(2)特殊材料

再生晶圓(Reclaim wafer)與矽晶圓重生(ReBirth):提供半導體客戶矽晶圓再生與重生之銷售與服務。本公司專利開發之 VE (Vapor Etching) 設備,應用於 ReBirth/矽晶圓重生,主要是幫半導體客戶去除測試或擋控矽晶圓上之薄膜所提供之代工服務。

銅磁晶片/CMW 及相關產品:本公司之產品包含 CMW/銅磁晶片、CM μ LED/銅磁微發光二極體、大功率紅光 LED 及 TransVivi Pixel /創視畫素封裝體等,主要應用於 Mini & Micro LED 顯示屏。

(3)濕式化學品

產品為半導體級 Stripper(去光阻液),產品競爭優勢及特點為可配合客戶製程需求調整配方,達到製程最佳化、無 Hydroxylamine (HDA)配方 (HDA 有爆炸及斷料風險)、無 N-甲基吡咯烷酮(NMP)配方 (NMP, 2022 歐盟開始管制),可完全滿足環保與先進製程客戶需求。

(4)玻璃通孔基板

使用精密雷射技術與氣相蝕刻,稱為 LADY(Laser Arrow Decomposition Yield) 技術,進行玻璃鑽孔的製造,提應用於半導體高階精密封裝。

(5)精密設備暨零組件

與太陽能相關之雷射設備供應商合作,依客戶需求,參與設備規格設計、軟硬體模組安裝、設備買賣及售後服務,主要應用於太陽能電池片與太陽能模組。另精密零組件主要為鎢繩買賣,應用於半導體長晶 (Ingot Pilling)製程。

4.計劃開發之新產品(服務)項目:

- (1)擴增 ReBirth 晶圓重生市場,以四萬片月處理量為一個生產模組,持續擴產。
- (2)應用 CM μ LED/銅磁微垂直發光二極體,組成 RGB 三色發光二極體之無打線封裝結構,稱為 TransVivi Pixel (創視畫素),應用於 Mini LED 及 Micro LED 顯示屏,並申請多國專利。
- (3)開發二元/三元混氣技術,應用於半導體等電子產業。
- (4)開發多項新品項氣體產品,如 BCl₃ (三氯化硼)、AHF(無水氫氟酸)、CO(一氧化碳)、WF₆(六氟化鎢)等一級製造技術,應用於半導體、光電等產業。
- (5)開發濕式化學品:去光阻液、化學機械研磨清洗液及化學機械研磨液。
- (6)設立玻璃通孔基板產線:提供各種尺寸與圖案之玻璃基板,應用於半導體高階封裝產業。

(二)產業概況：

1.產業之現況與發展：

本公司營收以生產並銷售給半導體產業之前段與封裝、平面顯示器前段等各類製程所需之精密化學品（特殊氣體）為主，次之為太陽能產業相關之特殊材料、雷射設備及零組件等，及自行開發之產品 ReBirth 代工服務、TransVivi Pixel 創視畫素及半導體晶圓製造之去光阻液。其主要市場之發展狀況分析如下：

(1)半導體產業

自從 OpenAI ChatGPT 問世後，在人工智慧等新應用驅動下，半導體景氣大幅好轉，加上 AI PC & AI Phone 等新產品即將問世，另外，在電動汽車的需求下，汽車半導體含量持續增加，車用半導體需求呈現短缺現象，故全球半導體在新品應用發酵下，景氣可以期待。

綜合各家研調機構對半導體產業景氣預估，預估 2025 年半導體產業成長率落在 5%至 10%區間。

承上所述，半導體產業 2025 年呈現成長態勢，本公司將專注於生產之特殊氣體應用於半導體產業之銷售競爭力，惟特殊氣體產業不論在國內或是全球屬非常獨特的產業型態，其與其他半導體材料製造商共稱“半導體材料製造業”。前段半導體材料製造業包括矽晶圓、濕式化學品、石英製品、特殊氣體、金屬靶材與光阻液等材料生產；後段半導體材料製造業包括導線架、芯片載板、模壓樹脂與金線等材料生產，為半導體最主要之十大原物料，其中特殊氣體、濕式化學品、金屬靶材與光阻液等同時亦為平面顯示器前段生產之主要原物料。將各國的乾式化學品製造商做一整合分析，並以客戶用途來分類，可彙整出下述五個區塊：

- A.蝕刻氣體(氟、碳、氯系列)
- B.層膜氣體(氮、氧、矽、鎢系列)
- C.參雜氣體(硼、磷、砷、氫系列)
- D.曝光/回火準分子雷射氣體(氬、氦、氙系列)
- E.大宗氣體 Bulk Gas(氮氣、氧氣、氬氣)

到目前為止，全球未有特殊氣體製造商可以完整供應客戶乾式化學品之所有需求，因此該行業與半導體及平面顯示器地區性發展並無直接關連，反而與半導體及平面顯示器產業全球整體發展具高度相關，故以地區性角度來看，此消彼漲是謂正常現象。而本公司之乾式化學品，主要為上述 A.蝕刻氣體與 D.雷射氣體，未來銷售地區性成長與否，將與各國對半導體及平面顯示器的支持與擴建具有緊密關聯。

(2)平面顯示器產業

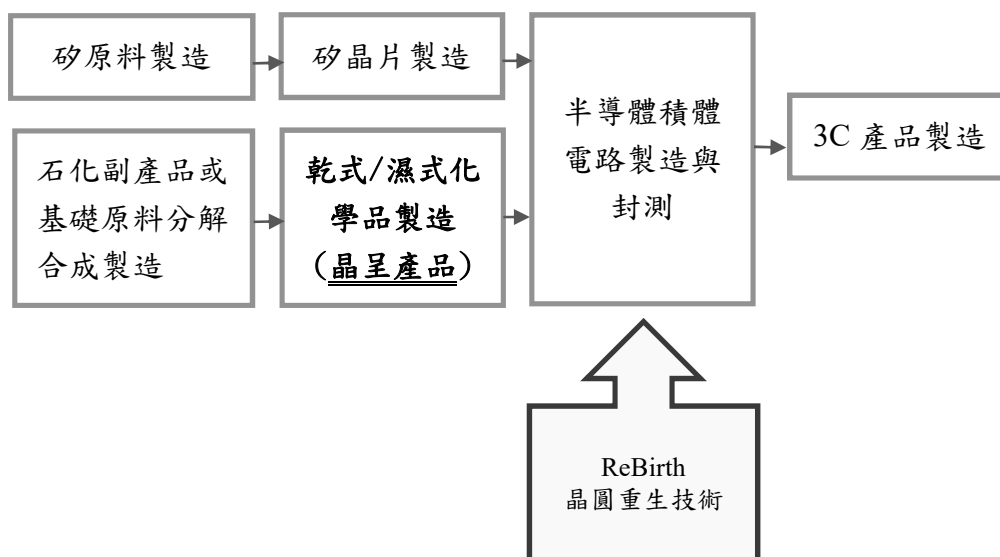
LCD 產業因為過度競爭，導致價格崩跌，目前手機與筆電的顯示器已從 LCD 轉為 LTPS-OLED 顯示器，在 LTPS-AMOLED 方面，本公司的雷射氣體 XeCl 可應用於 LTPS 電晶體的回火製程，預期對營收可產生貢獻。

(3) Micro/Mini LED 產業

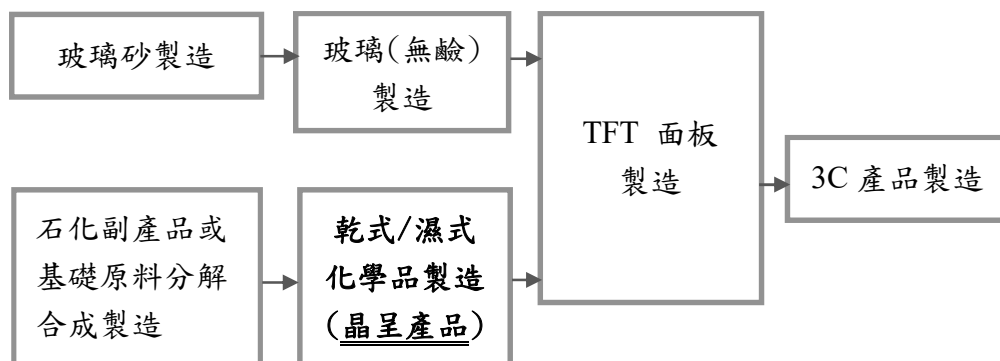
本公司多年研發的銅磁晶片(CMW)，可廣泛應用於 Mini/Micro LED 產業，具有提高晶粒產能，薄型化與解決巨量轉移難題等優勢，本公司進一步開發出 TransVivi Pixel (創視畫素) 封裝體，可應用於大尺寸如 136 吋以上顯示器，可達到 E8K 顯示效果，預期本公司的 TransVivi Pixel 應用於 Mini/Micro LED 產業未來發展可期待。

2.產業上、中、下游之關聯性

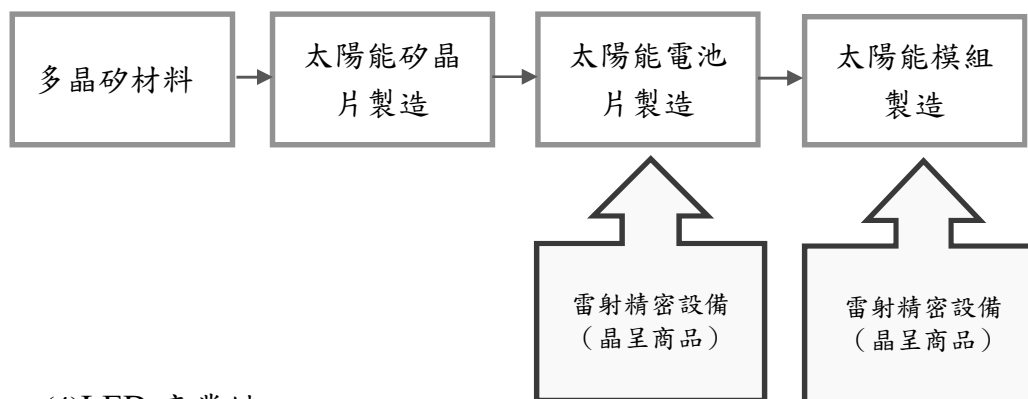
(1)半導體產業鏈



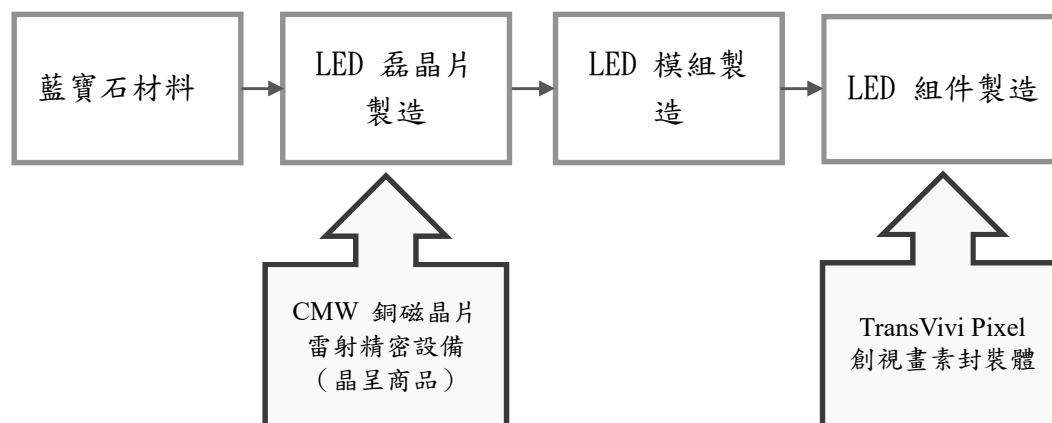
(2)平面顯示器產業鏈



(3) 太陽能產業鏈



(4) LED 產業鏈



3. 產品之各種發展趨勢

(1) 產品之各種發展趨勢

A. 精密化學品（特殊氣體）

台灣在地生產的特殊氣體廠商不多，且大都為國外大廠在台所設立的分公司，大部分客戶早期習慣向國際老牌大宗氣體(Bulk Gas)公司一次購足所需的特殊氣體，由於各製造商各自專精的強項不同，在售價與穩定供應上，常常無法全面滿足客戶的要求，所以客戶漸漸地開始分類購買，以專精項目為前提，而不再要求統包供應。此採購模式的改變，讓一些供應項目不多，但專精的製造商開始嶄露頭角，而本公司的特殊氣體製造銷售，將是該演變下的成功案例之一。目前 C4F8(八氟環丁烷)高純精餾技術已於 2018 年 8 月於本公司竹南基地試產成功並開始供貨給各大客戶，2019/Q1 通過製程技術改良，產能大幅提升 30%，另外質量方面的進展也同步精進，對於目前客戶奈米級的工藝為不可或缺的重要物料。

這樣的生產與採購模式，近年來已成為一種不可逆行的發展趨勢，各專業製造商會在自己專精的領域上，展開關聯研發，進而增加新的項目，擴大並充實銷售網絡。

由於台灣各環保與勞安法規日趨嚴謹，各製造商不僅成立專業的環安衛部門，且與同業或客戶在消防上實行聯防作業，各知名製造商更在防災設備上大舉投資，從感測、監控到除害無一遺漏，本公司在此方面，實為產業樣板。

化工生產技術與環安衛系統設計執行，這兩項已成為特殊氣體製造最重要的兩個環節，也因為專業性與繁瑣度實在太高，對有興趣想進入這市場的新加入者，已經築起了一座高牆，該產業未來的發展，將朝自製自銷，以縮短供應鏈、專業分工與大者恆大發展。

本公司在此趨勢下，於 2022 年規劃及發包建置特殊氣體二廠，於 2024Q1 完工，並於 2024Q4 開始動工特殊氣體三廠，除了持續落實技術自主，生產在地化，以強化公司競爭力，更能增進相關特殊氣體需求產業健全發展，避免客戶受制於進口諸多限制，達到公司和客戶雙贏發展。

B.特殊材料

晶圓重生(ReBirth)係由本公司歷經 10 餘年自行研發與測試完成之特殊設備與技術，已於 2018 年底問世，主要應用是為半導體客戶去除測試控片(Monitor wafer)或擋片(Dummy wafer)上之薄膜，讓使用過的矽晶圓可以回收再使用。

因近年來半導體業持續蓬勃發展，各晶圓廠與再生晶圓廠皆緊鑼密鼓的擴廠增量，再者長期以來各晶圓廠與再生晶圓廠皆有無法去除之膜種，對晶圓廠，對再生晶圓廠皆是無形的成本，此外，由於半導體先進製程之矽晶圓上之膜種多樣且複雜，現有之晶圓再生廠無法處理，造成半導體廠必須被迫將那些矽晶圓報廢。透過晶圓重生的技術可去除各式膜種，藉以提高晶片的使用壽命，讓報廢晶片起死回生，藉此達到效益極大化，此服務預期以每四萬片為一個生產模組，配合客戶需求，進行擴產。

銅磁晶片(CMW)及相關產品係由本公司開發之特殊複合材料，主要應用於 Mini & Micro LED 顯示屏。

在 Mini LED 及 Micro LED 發展上，目前業界普遍存在速度慢、良率低、成本高的巨量轉移難題，造成 Mini LED 及 Micro LED 應用難以普及化。由於採用無基板晶粒做巨量轉移，晶粒在製程中容易因外力造成晶粒受損，影響到後製程良率，目前此一瓶頸尚待克服。

銅磁晶片 (CMW, Copper Magnetic Wafer) 是本公司經過多年研發及無數次和客戶實際驗證所開發出之特殊複合材料，此材料具備導磁性、高散熱、低熱膨脹係數、超薄之特性，非常適用於在 LED chip 微型化的發展。由於銅磁晶片具有極佳的導磁特性，可有效解決 Mini & Micro LED 在巨量轉移(Mass Transfer)所碰到的瓶頸，目前市面上最快的 Mini & Micro LED 分選機，最快為 18 萬顆/小時，但以磁性巨量微整列設備對銅磁晶片承載發光層之晶粒做巨量轉移，可以達到 600 萬顆/小時，可大幅提升業界產能與降低成本，目前本公司可以提供 D50、

D75 及 D100 等尺寸的 Mini & Micro LED，讓客戶可以直接使用銅磁晶片承載發光層之晶粒做磁性巨量微整列與磁性巨量轉移，加速 Mini & Micro LED 的普及化。

此外，本公司透過上下游製程整合，開發出大功率紅光 LED(可應用在照明、燈號與車用產業)、銅磁微發光二極體(CM μ LED)及 TransVivi Pixel 創視畫素封裝體(可應用在各尺寸直顯透明與非透明顯示屏及背光顯示屏)，讓 Mini LED 及 Micro LED 之廣泛應用可逐步落實。

C.濕式化學品

半導體濕式化學品如酸、鹼、光阻、去光阻液、研磨液等在半導體工業上為主要生產材料，其中本公司的產品去光阻液，主要應用於金屬層中的光阻去除，該化學品需符合環保趨勢，主要產品技術競爭優勢及特點為，可配合客戶製程需求調整配方，達到製程最佳化、無 Hydroxylamine (HDA)配方 (HDA 有爆炸及斷料風險)、無 N-甲基吡咯烷酮(NMP)配方 (NMP，2022 歐盟開始管制)，可完全滿足環保與先進製程客戶需求。

去光阻液(Stripper)目前全球產值達新台幣 150 億元，台灣產值達新台幣 50 億元，是值得投入資源、獲取利潤的市場規模。除了 Stripper 的技術研發，本公司另專注於 CMP Cleaner 及 CMP Slurry 的技術開發，期許不久的將來有新產品問世。

D.玻璃通孔基板

半導體高階封裝領域，需要使用高強度與大面積的載板，承載 GPU、HBM 等半導體高階晶片，進行 AI 運算，故此產品的發展具備良好的市場，本公司所開發的 LADY 技術，可製作直通孔的玻璃基板，可滿足產業需求，未來前景可期。

E.精密設備暨零組件

本公司之精密設備，係指應用於太陽能產業之雷射工具機。雷射設備是提升太陽能電池片與太陽能模組轉光電換效率最重要設備之一，以先進“P 型局部背鈍化-PERC”加上“選擇性射極-Selective emitter”製程（結晶矽太陽能電池片製程）應用為主。此設備之未來發展，將朝自動化系統改良、產能提升與光束質量優化邁進，以期待在下一個世代的產線達成產能提升 20%，光電轉換率提升至 24%為目標。本公司代理之雷射設備具有高量產產能、低成本及高轉換效率優勢。

精密零組件係以純鎢長晶繩為主要，銷售專為直拉單晶製造法單晶爐使用之純鎢長晶繩。鎢繩特性為拉力強度高、耐熱性強、耐腐蝕性強、使用壽命長、可靠度高、具有柔軟性且大幅降低自轉特性，進而有利於使用者達到成本降低並取得競爭之優勢。鎢繩除了與 8~12 吋半導體矽晶圓長晶爐設備擴增而同步成長外，應用鎢繩制震的特性，在製造 TFT 大尺寸平面顯示器時，將取代傳統的傳送承載盤，因總重量變輕且震動減少，在耗能方面將大量省電，同時亦能減少破片率。

4.競爭情形

產品別	主要產品	競爭者
精密化學品	氟碳類蝕刻氣體	美國英特格、日本昭和電工、日本關東電化、日本中央玻璃與韓國 Foosung Group
	稀有類雷射氣體	美國 NOVA、美國普萊克斯、德國林德聯華、法國液化空氣
特殊材料	再生晶圓	台灣 RS Tech、台灣中砂、台灣辛耘
	晶圓重生	無
	銅磁晶片、大功率紅光 LED、銅磁微發光二極體 (CM μ LED) 及 TransVivi Pixel 創視畫素	無
濕式化學品	去光阻液(Stripper)	美國杜邦、3M、英特格
玻璃通孔基板	玻璃通孔基板	AGC、Dow Corning
精密設備暨零組件	雷射設備	法國 Innolas、台灣友晁能源材料、德國 MAMZ Group

(三)技術及研發概況：

1.所營業務之技術層次及研究發展：

本公司之精密化學品（特殊氣體）製造技術，多屬自行開發，包含從容器製作、純化到微量分析，已於 2016 年取得 ISO 9001：2015 國際品質系統認證。2018 年 C4F8(八氟環丁烷)高純精餾技術試產成功，後續並持續研究 SiF4(四氟化矽)、C4F6(六氟丁二烯)及 CH2F2(二氟甲烷)等半導體蝕刻用氣體。藉由多年來累積的雄厚經驗，使各產品的不純物降至 ppm 或 ppb 等級，而其純度已達世界級最高水準。

目前專利申請狀況，截至 2025 年 1 月，已獲得批准的專利數量 59 件，申請中待審核批准的專利為 58 件，其中已通過的專利，CM μ LED 為 40 件，ReBirth 相關為 10 件，氣體相關 3 件，TGV 為 2 件，其他為 4 件。

關於銅磁晶圓相關技術，主要針對磊晶與 CMW 結構、封裝體架構、製程方法及巨量轉移方法等進行佈局，對於公司發展 CMW 應用於 MicroLED 封裝體、VCSEL、大功率元件、大型顯示器等產品發展具有智權保護的作用，未來可進一步對客戶做專利授權與防止競爭者的專利訴訟。

針對 ReBirth 相關技術，主要是針對除膜的方法及設備與檢測技術進行專利佈局，可避免競爭者侵犯智慧財產權，及增加客戶的信心度。

氣體專利主要針對氣體安全防護做佈局，可提高公司在危險氣體的操作與防護上的安全性。針對 TGV 及其他技術領域亦有佈局，以利未來公司長期發展所需。

半導體及太陽能高科技材料及設備之專業行銷通路商所提供之服務，其所須具備之技術不僅限於產品之生產與開發，而是需要經營管理、銷售及應用等相關人員與知識之整合始能為之。本公司以”品質掛帥”為前提，串聯”生產研發為核心，貿易服務為觸角”兩大核心主軸，永續經營運轉。不僅投下大量資源在產品研發上，在新貿易商品的引進亦不遺餘力，更擁有豐富經驗之經理人與經營團隊，不但能提供客戶技術支援，亦可有效擴大供應產品應用層面，提供上、中、下游共創三贏的局面。

2.最近年度及截至年報刊印日止，投入之研發費用：

單位:新台幣仟元

年度	113 年度	114 年截至 3 月 31 日止
研究發展費用	78,833	-
營業收入	1,016,860	-
研究發展費用佔營業收入淨額比例	7.75%	-

註：截至年報刊印日止尚未揭露 114 年第 1 季經會計師核閱之資料，故無季報數字供參。

3.開發成功之技術或產品：

年度	技術分類	開發成功之技術或產品
105~106	特殊氣體	(1)氟碳類特殊氣體純化技術
	CM _μ LED	(2)直下式 LED 金屬基板製作
	ReBirth	(3)「具有多腔體之氣相蝕刻設備」第一代機型開發
107	CM _μ LED	(1)直下式 LED 金屬基板應用於 LED 之製程、電性及散熱性驗證
	CM _μ LED	(2)直下式 LED 金屬基板量產技術研究
	ReBirth	(3)「具有多腔體之氣相蝕刻設備」第二代機型開發
108	CM _μ LED	(1)直下式 LED 金屬基板應用於 LED 之製程、電性及散熱性驗證
	CM _μ LED	(2)直下式 LED 金屬基板量產技術研究

年度	技術分類	開發成功之技術或產品
	ReBirth	(3)「具有多腔體之氣相蝕刻設備」第三代機型開發
109	CM μ LED	(1)應用直下式 LED 金屬基板，製作 CM μ LED，並與策略合作夥伴進行磁性巨量轉移與檢測設備的設備開發
	ReBirth	(2)30K ReBirth 晶圓重生工廠建置量產與檢測設備及相關流程，進行商品化作業
110	CM μ LED	(1)CM μ LED 0404 封裝體
	CM μ LED	(2)CM μ LED 封裝體之量產技術開發
	ReBirth	(3)精密旋轉式蝕刻機開發
111	ReBirth	(1)全自動精準分膜機
	CM μ LED	(2)CMW 應用於 VCSEL 元件，提高散熱增進元件效率
	CM μ LED	(3)CM μ LED 0404 封裝體之無打線封裝技術
112	ReBirth	(1)製程改善工具機開發
	CM μ LED	(2)TransVivi Pixel 封裝體技術 (3)VCSEL 陣列/CMW 元件應用於 LiDAR 技術開發
113	TGV	開發出玻璃通孔技術，應用於半導體高階封裝

(四)長、短期業務發展計畫：

1.短期業務發展計畫

- (1)提升特殊氣體、晶圓重生/ReBirth 及貿易商品的市佔率。
- (2)建立晶圓重生/ReBirth 月產 4 萬片產能及拓展日本、新加坡、大陸海外銷售。
- (3)建立 TGV 月產 1 萬片產能及銷售。
- (4)拓展銅磁晶片/CMW、銅磁微發光二極體晶粒/CM μ LED、大功率紅光 LED 及 TransVivi Pixel 創視畫素封裝體應用於 Mini & Micro LED 顯示器市場。

2.長期業務發展計畫

- (1)持續增加特殊氣體的製造銷售項目。
- (2)開拓韓國、印度、日本、美國、歐洲及新加坡特殊氣體與 stripper 外銷市場。
- (3)透過氣態分解溶蝕技術開發新應用。
- (4)與“磁轉銅盟”策略夥伴共同開發 Mini & Micro LED 晶粒巨量轉移、巨量檢測及巨量修補量產設備。
- (5)優化銅磁晶片/CMW、銅磁微發光二極體晶粒/CM μ LED、大功率紅光 LED 及創視畫素封裝體/TransVivi Pixel 製程，降低成本，提升競爭力。
- (6)銷售 TGV 玻璃穿孔基板擴大市佔率。
- (7)持續開發代理商品，從代理商品中發現新商機。
- (8)持續開發新材料與設備技術，落實在地化製造量產。

二、市場及產銷概況：

(一)市場分析：

1.主要產品（服務）之銷售（提供）地區：

單位：新台幣仟元；%

地區別 \ 年度		112 年度		113 年度	
		銷售額	比率	銷售額	比率
內銷		681,198	83.56	682,443	67.11
外銷	中國	9,222	1.13	170,886	16.81
	亞洲	110,147	13.51	151,354	14.88
	歐洲	14,641	1.80	12,177	1.20
	其他	-	-	-	-
	小計	134,010	16.44	334,417	32.89
合計		815,208	100.00	1,016,860	100.00

2.市場佔有率：

根據 Statistics MRC 的數據，全球半導體氣體市場預計到 2028 年將達到 164.4 億美元，預測期內增長 9.51%，推估 2023 年全球半導體氣體市場規模為 104.4 億美元，而依本公司 2023 年應用於半導體之特殊氣體營業收入約為新台幣 7.8 億元(約為 0.25 億美元)，估算本公司占該年度全球用於晶圓製程材料之電子氣體市場規模佔有率為 0.24%。

3.市場未來供需狀況及成長性：

根據產業研究報告顯示，2020~2025 年半導體產業之主要成長動力除來自人工智慧、通訊、電腦及消費性電子產品外、車用、工業、醫療及其他的終端應用市場需求也很旺盛，每年將有 4%~5% 的複合成長率。

在顯示器產業上，因 LCD & OLED 產品受限於玻璃尺寸因素，無法製作成大型顯示器(超過 136 吋)，本公司所開發的 TransVivi Pixel 創視畫素封裝體，可製作大型戶外及室內顯示器，應用廣泛，可以期待其成長性。

根據國際半導體設備材料產業協會(SEMI)最新更新全球晶圓廠預測(World Fab Forecast)報告顯示，預計在 2020 年至 2025 年期間全球將新建 35 座晶圓廠，其中台灣則預計將新增 5 座。此外新應用如 5G、物聯網、高速運算、人工智慧、車用電子等會逐步使半導體晶片需求大增，將對半導體整體產值 2020 年起連續數年保持 5~7% 年增成長率。另外，因應溫室氣體排放減量政策，新型態環保“半導體清腔製程”所需之替代性潔淨氣體需求量將會大增。而本公司的乾式化學品，主要為蝕刻氣體與雷射氣體，未來地區性銷售成長與否，亦受到各國對半導體與平面顯示器的支持與擴建，然而本公司受惠於未來半導體產業前景看好下，再加上特殊氣體方面全球的供應商不多且多為國外大廠，如液化空氣集團、林德集團、普萊克斯集團等，由於經營特殊氣體需要特殊許可，故本公司專業的特殊氣體項目在國內之市場佔有率平均約 15%，未來伴隨半導體產業整體增長，將能持續擴大產品市場佔有率到 35%~40%，另外加上新型環保潔淨氣體本公司業已

準備妥當，預期整體營收呈成長趨勢將合理可期。

在濕式化學品方面，本公司於晶呈二廠建置年產能 288 噸的去光阻液生產設備，未來將配合客戶需求，持續擴產，突破目前外商所寡占的去光阻液市場，將本土化去光阻液成為半導體產業鏈的一環，成長可期。

在玻璃通孔基板的應用，於晶呈二廠成立製造工廠，可提供客戶 5,000 片以上 (300mm wafer 尺寸) 當量的月產能，可供應半導體高階封裝客戶的需求。

在特殊材料及精密設備暨零組件部分，係屬商品貿易買賣為主，在半導體產業有 8 吋跟 12 吋再生晶圓、純鎢長晶繩、碳化矽削磨微粉；在太陽能產業有石英坩堝、粗糙化處理的化學品、回收設備、雷射設備等。而本公司與國外合格供應商長期合作，為維持貨源穩定性，代理其產品於國內市場銷售，依據 IEK 研究報告顯示，預測至 2025 年半導體材料市場規模，每年將呈 2%~3% 以上之成長。

本公司獨自開發的 ReBirth 氣體晶圓重生技術，可支援各大晶圓廠的晶圓重生需求，使晶圓廠營運成本降低，並達成環保性的目標，後勢可期。

展望未來整體全球 IT 產業（資訊產品及通訊產品）及綠能產業（含電動車發展市場）的資本將持續維持穩定成長，將帶動本公司在相關產業上之製造及商品貿易之營收成長動能。

4.競爭利基：

(1) 本公司擁有特殊氣體在製程上從容器製作到純化與微量分析之關鍵技術，對產品品質掌控度非常高且在地供應，具高度競爭優勢。

鑑於各類特殊氣體都具有一定的危險性，故客戶廠內的庫存都以極少庫存量為原則，採用完隨時採購之模式。因國內在地生產的乾式化學品廠商不多且大都為國外大廠在台所設立的分公司，故本公司之特殊氣體，都是專精之生產製造項目，其在地供應鏈非常短，能提供給客戶最快速的到貨服務，使客人在需求數量與安全庫存上無後顧之憂。另本公司擁有製程上，從容器製作到純化與微量分析之關鍵技術，故對產品品質掌控度非常高。

(2) 本公司具備特殊氣體製造研發能力，成為客戶首要之合作供應商

台灣半導體製程要求日趨嚴謹，不僅對特殊氣體之純度與等級要求提升，其種類亦越來越奇特。客戶在新製程氣體需求上，傾向與具研發能力的製造商直接討論，而本公司因具備特殊氣體製造研發能力，故為客戶首要邀約之對象。且對於新產品開發，本公司亦盡全力提供合宜的少量樣品予客戶測試，待客戶製程研發成功後，該特殊氣體即成為產業指標。

(3) 本公司具備符合法令規定之特殊氣體生產基地及設備

鑑於國內環保與勞安法規日趨嚴謹，本公司不僅成立專業的環安衛部門，且與同業或客戶在消防上實行聯防作業，更在防災設備上大舉投資，從感測、監控到除害，無一遺漏，屬於國內領先廠商。本公司之精密乾式化學產品已於 2016 年取得 ISO 9001: 2015 國際品質系統認證。未

來將申請 IS14001 & IS45001 的認證。

化工生產技術與環安衛系統設計執行，這兩項已成為特殊氣體製造最重要的兩個環節，也因為專業性與繁瑣度很高，對有興趣想進入該市場的競爭者，已經築起了一座高牆。

(4)本公司具備產業專業人才，以提供整合服務

本公司具備有經驗的專業人才及有效率的行銷通路，專精於半導體、液晶顯示裝置、發光二極體及太陽能產業領域，依據客戶對產品之需求與要求，尋找合宜供應商並與之溝通討論，以達成客戶所需，同時提供銷售、安裝與售後服務等全方面的整合服務，以創造三方雙贏局面。

(5)本公司具備高物流處理能力

本公司能因應客戶的不同需求，提供完整之作業倉儲管理，以確保物流運作的高效率及安全性，亦同時達到減少人為作業疏失的效果。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

(1)有利因素

- A.台灣半導體業為全球要角，在永續發展經營下，晶圓廠陸續擴建中，有利於主力產品特殊氣體及材料零組件等業務拓展。
- B.特殊氣體之生產研發技術皆為本公司所有且在地供應，未來產能擴充或增設新的產品線之速度會比其他競爭者快。
- C.生產特殊氣體所需之人力不多，故能節省較多生產成本且生產零污染。
- D.全球沒有一家特殊氣體製造商能夠完整供應客戶乾式化學品之所有需求，因此客戶漸漸地開始分類購買，以專精項目為前提。而在經營特殊氣體方面，須取具政府核發之經營許可才能營業，本公司不僅專精在該行業並具備產業專業人才外，在生產設備上亦合乎法令要求及完備之作業流程，故重重關卡讓競爭者怯步，競爭力相較於本公司落後。
- E.本公司之精密乾式化學產品已於2016年取得ISO 9001:2015國際品質系統認證，提供客戶更佳之品質與作業保證。
- F.代理銷售的產品為具有市場競爭力的產品且供應商為國內外知名的大廠，本公司與各供應商皆為長期合作夥伴且維持良好互動關係，除了業務往來外，亦積極以合作生產方式取得彼此長期共同利益。
- G.本公司於貿易代理產業上有獨到的經營方式，著重在技術服務、專業規劃、及品質保證等三個方向提供客戶最佳選擇，非為單純的買賣仲介。
- H.本公司所研發的銅磁晶片符合Mini/Micro LED顯示器產業的趨勢。
- I.本公司所研發的ReBirth氣體晶圓重生服務，符合半導體產業需求與環保目標。
- J.本公司所研發生產的去光阻液，符合半導體材料產業本土化的策略發展，產品並符合環保法規具有產業競爭力。
- K.本公司所研發生產的玻璃通孔基板，符合半導體高階封裝需求，具備高度競爭力。

(2)不利因素及因應對策

- A.全球半導體每年步步成長已經為一種趨勢，但並非都集中在台灣發展，為因應此不確定性，本公司會在海外開設營業據點，並增加外銷比重，不僅減少可能的衝擊損失，更可以率先掌握當地的需求脈動。
- B.代理產品之代理權雖存在不確定因素，但本公司所代理之合約，大部分具有期滿自動續約之優先條件外，本公司所代理之產品為技術層次較高之電子業居多，本公司可提供完整的工程技術，使供應商與客戶對本公司之依存度頗高。另增加生產項目，以提升自有生產技術。

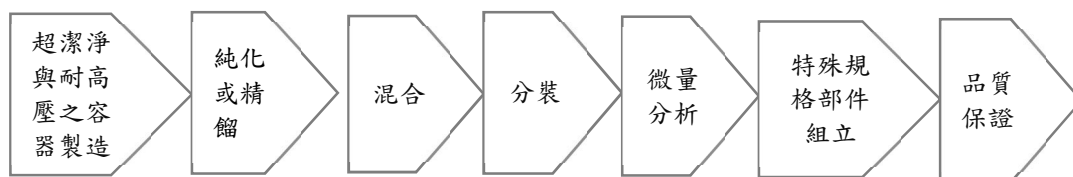
(二)主要產品之重要用途及產製過程：

1.主要產品之重要用途：

- (1)半導體蝕刻製程：C3F8（八氟丙烷）、C4F8（八氟環丁烷）、C4F6（六氟丁二烯）、CH2F2（二氟甲烷）、SF6（六氟化硫）。
- (2)半導體層膜製程：SiF4（四氟化矽）、Xe（氙）。
- (3)半導體清腔製程：F2/N2、F2/Ar/N2 mixture（氟混合氣）。
- (4)半導體曝光準分子雷射氣體：Xe（氙）、Neon Mixture（氖混合氣）。
- (5)平面顯示器蝕刻與清腔製程：SF6（六氟化硫）。
- (6)平面顯示器回火準分子雷射製程：Xe（氙）、Neon（氖）、Neon Mixture（氖混合氣）等。
- (7)可濕式蝕刻應用於高功率直下式 LED 磊晶片及 Micro LED 之精密材料：銅磁晶片（CMW）。
- (8)去除半導體金屬層表面的光阻：去光阻液。
- (9)玻璃通孔基板：半導體高階封裝載板。

2.產製過程：

特殊氣體之產製過程如下：



銅磁晶片(CMW)之產製過程如下：



(三)主要原料之供應狀況：

本公司精密化學品之主要原料為各種基礎化學品或中間體與合成品，供應來源有數家國外製造商，生產穩定及供應量充足。

(四)主要進銷貨客戶名單：

1.最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上供應商資料：

單位：新台幣仟元

年度 項目	112 年度			113 年度			114 年度截至第一季止 (註)		
	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係	名稱
1	Fluorine	94,425	29.52	無	史密斯	184,893	38.91	是	-
2	ASTOR	83,284	26.04	無	Fluorine	99,857	21.01	無	-
3	戊公司	32,679	10.22	無	丁公司	54,362	11.44	無	-
4	其他	109,430	34.22	-	其他	136,068	28.64	-	其他
	進貨淨額	319,818	100.00	-	進貨淨額	475,180	100.00	-	進貨淨額

註：截至年報刊印日止，尚未揭露 114 年第 1 季經會計師核閱之資料，故依「公開發行公司年報應行記載事項準則」之附表說明，本季數字不予揭露。

變動說明：

本公司對上述進貨供應商之進貨金額變動，主要係隨客戶訂單需求變化而有消長。

2.最近二年度任一一年度中曾占銷貨總額百分之十以上客戶資料：

單位：新台幣仟元

年度 項目	112 年度			113 年度			114 年度截至第一季止 (註)		
	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係	名稱
1	C016	505,389	62.00	無	C016	474,930	46.71	無	-
2	C002	83,979	10.30	無	C117	148,983	14.65	無	-
3	其他	225,840	27.70	-	其他	392,947	38.64	-	其他
	銷貨淨額	815,208	100.00	-	銷貨淨額	1,016,860	100.00	-	銷貨淨額

註：截至年報刊印日止，尚未揭露 114 年第 1 季經會計師核閱之資料，故依「公開發行公司年報應行記載事項準則」之附表說明，本季數字不予揭露。

變動說明：

客戶 C016、C117

客戶 C016 為國內半導體代工大廠，客戶 C117 為中國特種氣體供應廠商。本公司銷售上述客戶半導體蝕刻製程所需之特殊氣體。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料：

單位：人；%

年度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 3 月 31 日止
項目				
員工人數 (人)	研發人員	27	30	32
	業務人員	8	11	11
	管理人員	34	38	43
	製造人員	39	50	51
	合計	108	129	137
平均年歲(歲)		39	31	40
平均服務年資(年)		4.00	4.46	4.19
學歷分布 比率 (%)	博士	1.85	1.55	1.46
	碩士	23.15	23.26	23.36
	大專	60.19	63.56	64.23
	高中	14.81	11.63	10.22
	高中以下	-	-	0.73

四、環保支出資訊：

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

本公司生產過程中所產生之廢棄物並無污染產生，故無污染環境或環保支出之情形。

五、勞資關係：

(一)公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

1.員工福利措施與實施情形：

本公司依勞動相關法令辦理勞工保險、全民健康保險，使同仁有所保障。另本公司為充分照顧員工，由行政支援處統籌規劃員工之各項福利措施與運作，以提升員工福利。本公司之福利措施如下：

- (1)福利補助：結婚禮金、住院慰問、喪葬慰問等。
- (2)文康活動：年度旅遊、尾牙活動安排、部門聚餐等。
- (3)其它補助：三節禮金、員工酬勞、績效獎金、團體保險、出差/旅遊旅行平安險、定期員工健康檢查、特約飯店住宿優惠等。

2.員工進修及訓練：

本公司為提升人力資源素質與企業之核心競爭力，以達永續經營之目標，建立完整之教育訓練體系，以培養富有專業能力並兼具競爭力之人才。

(1)內部訓練：新進員工教育訓練、部門內部教育訓練、環境安全訓練、其他內部專業講師課程、直接人員訓練、消防逃生訓練、工安訓練、業務基本訓練、製程訓練、機器操作訓練等。

(2)外部訓練：各部門主管及員工依工作需求，申請派員參加外部企業機構舉辦之課程與訓練、客戶使用產品教育訓練、業務參加國際展覽推廣及產品展示等。

3.退休制度與實施情形：

自民國 94 年 7 月 1 日起配合勞工退休金條例之實施，依勞工退休金條例之規定，凡選擇新制或新制施行後到職之員工，公司按每月薪資百分之六提繳退休金，儲存於勞工退休金個人專戶，並依退休金條例之規定辦理退休相關事宜，本公司自成立至今尚無員工退休之情況。

4.勞資間之協議情形：

本公司依勞基法訂定各項規定，以維護員工權益，並定期舉辦勞資會議，對公司各項制度等問題採開放及雙向溝通方式，期使勞資雙方關係良好合諧及互動，並確保員工之各項權益取得公平合理的處理。故歷年來勞資關係和諧，無重大勞資糾紛產生。

5.各項員工權益維護措施

本公司各部門訂有完善的作業流程，並依據相關法令及內部控制規範，落實各項員工應有權益及應盡責任；此外公司有良好的溝通機制，重視員工及主管間的意見交換，公司也能據此作出最適當的處理，以維護員工及公司權益。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計，應說明無法合理估計之事實：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無因勞資糾紛而遭受重大損失。

六、資通安全管理：

(一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等：

在資通安全風險方面，本公司除制定資安相關管理規範外，並建立網路防火牆、郵件安全系統等安全措施，並對全體員工進行資訊安全教育訓練，以降低資安風險。相關資訊安全管理方案及資源投入如下：

- 1.每年檢視網路設備優化。
- 2.每年委請專業資安廠商進行資安演練，找出可能漏洞進行修補及風險分析與避險。
- 3.資安管理部門隨時關注可能之資安陷阱並即時公告同仁避免誤入陷阱。
- 4.每日備份公司機密資料，防止資料減失對營運造成不良影響。
- 5.每周異地備份公司機密資料，以防資料減失對營運造成不良影響。
- 6.隨時更新最新防毒軟體，避免資安漏洞曝露。
- 7.嚴設使用者權限，避免機密資料外洩。
- 8.每年汰換老舊電腦，避免產生資安漏洞。

本公司 113 年度至本年報刊印止，並未有重大資安事件發生。

(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情形。

七、重要契約：

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
授信契約	臺灣銀行	104.03.11~119.03.11	不動產擔保貸款	無
授信契約	彰化銀行	113.11.06~133.11.06	不動產擔保貸款	無

伍、財報狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況：

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	112年度	113年度	增(減)變動	
			金額	%
流動資產	770,299	709,880	(60,419)	(7.84)
不動產、廠房及設備	915,667	1,806,976	891,309	97.34
其他非流動資產	684,791	305,865	(378,926)	(55.33)
資產總額	2,370,757	2,822,721	451,964	19.06
流動負債	459,504	457,475	(2,029)	(0.44)
非流動負債	52,987	488,410	435,423	821.75
負債總額	512,491	945,885	433,394	84.57
股本	430,729	452,266	21,537	5.00
資本公積	1,078,834	1,014,225	(64,609)	(5.99)
保留盈餘	169,068	192,617	23,549	13.93
其他權益	(1,627)	1,615	3,242	199.26
非控制權益	181,262	216,113	34,851	19.23
權益總計	1,858,266	1,876,836	18,570	1.00
變動比例達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元之分析說明：				
1.不動產、廠房及設備增加：主要係因營運所需擴建廠房及購置設備所致。				
2.其他非流動資產減少：主要係因預付土地款之所有權登記已辦理完成轉列土地。				
3.非流動負債增加：主要係因長期借款增加所致。				
4.負債總額增加：主要係因長期借款增加所致。				

二、財務績效：

(一)最近二年度財務績效分析：

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	112 年度	113 年度	增(減)變動	
			金額	%
營業收入	815,208	1,016,860	201,652	24.74
營業成本	457,723	604,127	146,404	31.99
營業毛利	357,485	412,733	55,248	15.45
營業費用	195,397	230,560	35,163	18.00
營業淨利	162,088	182,173	20,085	12.39
營業外收入及支出	125	9,250	9,125	7300.00
稅前淨利	162,213	191,423	29,210	18.01
所得稅費用	45,387	36,741	(8,646)	(19.05)
本年度淨利	116,826	154,682	37,856	32.40
其他綜合損益	(1,744)	3,242	4,986	285.89
本年度綜合損益總額	115,082	157,924	42,842	37.23

項 目	年 度	112 年度	113 年度	增(減)變動	
				金額	%
變動比例達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元之分析說明： 營業收入、營業成本、本年度淨利及本年度綜合損益總額增加：主要係因 113 年國際半導體市場復甦，客戶需求增加所致。					

(二)預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

本公司預計未來一年度銷售數量，主要係依據總體經濟環境變化、產業動向及公司未來之發展方向所擬定之營運目標，預計未來營業規模仍屬成長階段，對財務業務發展及經營體質上將有絕對的助益。

三、現金流量：

(一)最近年度(113 年度)現金流量變動之分析說明：

期初現金餘額(1)	預計全年來自營業活動淨現金流量(2)	預計全年淨現金流出量(3)	現金剩餘(不足)數額(1)+(2)+(3)	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
320,537	249,258	(286,917)	282,878	-	-
單位：新台幣仟元 1.現金流量變動情形分析： (1) 營業活動淨流入 249,258 仟元，主要係因本期營運產生之現金流入所致。 (2) 投資活動淨流出 537,223 仟元，主要係取得不動產、廠房、設備所致。 (3) 籌資活動淨流入 247,066 仟元，主要係長期借款增加所致。 2.現金不足額之改善計畫：不適用。					

(二)流動性不足之改善計畫：本公司無現金不足之情形，故無流動性不足之虞。

(三)未來一年現金流動性分析：

期初現金餘額(1)	預計全年來自營業活動淨現金流量(2)	預計全年淨現金流出量(3)	現金剩餘(不足)數額(1)+(2)+(3)	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
282,878	545,752	(668,394)	160,236	-	-
單位：新台幣仟元 1.營業活動產生之預計淨現金流入，主係預計營運持續成長，營收增加所致。 2.預計全年淨現金流出，主係預計資本支出及現金股利支出。 綜上，未來年度之現金部位尚不虞匱乏。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

本公司最近年度重大資本支出主要為擴展業務需求之建廠工程及購置設備，由於本公司營運狀況良好，來自於營業活動之現金流入穩定，建廠及購置設備之資金來源係以自有營運資金及長期銀行借款支應，故對公司財務業務並無重大影響。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

(一)最近年度轉投資政策

本公司基於營運需求及未來發展因素而進行轉投資，就轉投資事業的組織型態、設置地點、市場狀況等項目進行詳細評估，作為投資決策之依

據，並由執行部門遵循內部控制「投資循環」及「取得或處分資產作業程序」執行投資相關事宜。此外，本公司亦對已投資之事業隨時掌握其營運狀況，以利投資後之追蹤管理。

(二)獲利或虧損之主要原因、改善計畫

本公司民國113年度採權益法認列之投資利益為新台幣16,774仟元，未來將持續積極拓展業務及擷節開支，以維持穩定獲利。

(三)未來一年投資計畫

未來本公司仍將以長期策略性的角度審慎評估投資計畫，以因應未來市場與產能擴充之需求，持續強化公司競爭力。

六、最近年度及截至年報刊印日止，風險事項分析評估：

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1.對公司損益之影響：

(1)利率變動：

本公司 113 年度向銀行借款之利息費用為 9,393 仟元，佔營業收入淨額之 0.92%，比例微小顯示利率變動對本公司營運並未有重大影響。本公司隨時評估市場利率變化情形，並與往來之銀行維持良好關係，適時爭取最適利率並以短中長期融資額度搭配使用，以降低利息支出，故市場利率變動對本公司損益並未造成重大影響。

(2)匯率變動：

本公司進貨廠商以國外居多，主要以美元及人民幣計價，而銷貨多以美元計價，113 年度兌換(損)益為 9,111 仟元，佔本公司營業收入淨額之比例為 0.90%，本公司在外幣資金管理上採穩健保守原則，以自然避險為主，將外幣計價產品收入之外幣現金用來支應以外幣計價採購產生之外幣應付款項，或視適當時機結售外匯部位，盡力規避匯率變動所可能造成之不利影響。

(3)通貨膨脹：

本公司無因受通貨膨脹而有重大影響之情形，且本公司對客戶及供應商之報價，以市場之機動調整居多，故對本公司損益影響有限。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司專注本業經營，財務政策以穩健保守為原則，並無從事高風險、高槓桿之投資，有關資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策，將依本公司訂定之「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產作業程序」相關辦法規定，並考量財務業務需要辦理。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

1.未來研發計畫

(1)應用本公司之氣相蝕刻機台專利，開發相關設備應用於半導體晶圓去

膜再生(ReBirth) 及半導體設備零件再生處理，展開研製量產型設備與相關製程技術，以每四萬片為一個生產模組，進行擴產。

- (2)研製銅磁晶片(CMW) ，開發精密加工製程技術，應用於高功率直下式 LED 磊晶片及製作成 RGB 三色表面發光封裝體 (創視畫素 TransVivi Pixel)，可應用於 Mini/Micro LED 直接顯示器，並開發磁性巨量轉移等相關核心技術，與上游設備商及顯示器廠商合作開發相關應用，2023 年設立 TransVivi Pixel 產線，於 2024 年製作成 136 吋以上的 LED 顯示器，導入至終端應用。
- (3)開發高壓氣體用之容器表面處理技術，可應用於高純度之半導體氣體產品儲存及品質管理，以符合半導體先進製程之品質需求。
- (4)持續開發各式半導體級高純度氣體產品，如 F2/N2、AHF、BCL3、WF6、CO、C4F6 等，應用於相關產業。
- (5)持續研究銅磁晶片在垂直共振腔表面發射雷射 (VCSEL) 的散熱應用研究。
- (6)研究玻璃通孔基板應用於半導體高階封裝載板。

2.預計投入研發費用：

本公司為厚植公司之競爭力，維持市場優勢，對於研發創新不遺餘力，並朝向符合各類市場需求及科技潮流的產品發展，本公司預計投入之研發費用將依新產品及新技術開發進度逐步編製，並視營運狀況調整投入金額，以確保本公司競爭優勢。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司各項業務之執行均朝向符合主管機關法令規定辦理，並隨時注意國內外重要政策更動及法律變革，蒐集相關資訊，以充分了解掌握外在資訊。必要時諮詢相關專業人士意見，以提供經營階層決策參考，即時調整本公司營運策略。最近年度及截至年報刊印日止，本公司尚無發生國內外重要政策及法律變動而對本公司財務業務有重大影響之情事。

(五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司隨時注意半導體及光電產業之技術發展演變，並隨時針對客戶需求及產業供需變化進行溝通及瞭解，以掌握市場趨勢，保有市場競爭力。在資通安全風險方面，近年來資通安全風險大增，國內外資安事件頻傳，本公司亦同步強化資通安全相關事項，除制定資安相關管理規範外，並建立網路防火牆、郵件安全系統等安全措施，並對全體員工進行資訊安全教育訓練，以降低資安風險。因此科技改變及產業變化對本公司財務業務尚無重大影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司一向秉持專業和誠信的經營原則，並且非常重視企業形象，截至年報刊印日止，並無企業形象改變造成企業危機之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司於 112 年 1 月 3 日併購台灣芯電應用科技股份有限公司，取得 70% 控制性股權。台灣芯電目前主要產品技術開發為去光阻液 (Stripper)，其主要產品競爭優勢及特點為可配合客戶製程需求調整配方達到製程最佳化、無 Hydroxylamine (HDA) 配方 (HDA 有爆炸及斷料風險)、無 N-甲基吡咯烷酮 (NMP) 配方 (NMP，2022 歐盟開始管制)，可完全滿足環保與先進製程客戶需求。

據統計，Stripper 目前全球產值達新台幣 150 億元，台灣產值達新台幣 50 億元，是值得投入資源、獲取利潤的市場規模。台灣芯電的 Stripper 已經過客戶認證並開始交貨。除了 Stripper 的技術研發，台灣芯電另專注於 CMP Cleaner 及 CMP Slurry 的技術開發，期許不久的將來有新產品問世。

展望後市，此次併購案以台灣芯電的濕式化學品研發能力與技術實力為本，透過晶呈科技的資本募集能力及業務行銷實力，雙方在資源上取得互補，有助於提升未來營運成長動能。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

擴充廠房可使本公司提升生產能力以承接更多的客戶訂單，進而提升營收與獲利，對於本公司鞏固市場地位、強化接單能力、擴大市場佔有率將有所助益，未來將逐步擴大營業規模，將有利於達成公司營運目標並增加營收及獲利。

本公司擴廠計畫已考量產業發展趨勢及客戶需求成長等因素，並依相關之規定及法規執行，以期達成預計效益並同時將可能風險因素降低。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1. 進貨

本公司主要營業項目為精密化學品之製造與銷售、特殊材料及精密設備之銷售代理，其主要進貨為應用於半導體之特殊氣體及太陽能相關之設備等。不論特殊氣體採購或代理合約，本公司已與供應商建立長期良好的合作關係，且代理合約大部分有期滿自動續約之優先條件。本公司最近年度前三大進貨廠商佔全年度進貨淨額分別為 29.52%、26.04% 及 10.22%，本公司與供應商均維持良好的關係與風險分散的策略，面對市場供需變化，本公司均能尋求替代供貨來源因應，建立存貨管控機制，避免原料短缺風險，未來將持續視生產情況機動調整向各供應商採購比重及備料要求，確保生產所需原物料能順利供應。

2. 銷貨

本公司所銷售之各式特殊氣體應用產業範圍廣泛，目前主要銷售對象含括國內外晶圓代工、DRAM 製造及面板製造等電子產業廠商。本公司最近年度前三大銷貨客戶佔全年度營收淨額分別為 62.00%、10.30% 及 5.93%。

為因應銷貨集中之情況，本公司採取之因應措施如下：

① 技術延伸至新產品及新客戶

本公司積極投入特殊氣體新品項研發及產線擴增，在新製程氣體依客戶需求提供合宜的樣品予客戶測試，依測試結果提供客戶良好的技術與解決方案，滿足不同客戶的需求，並以此技術基礎開發新客戶。

②提供增加客戶黏著度之專業服務

本公司積極維持與客戶之良好合作關係，保持氣體供應品質穩定，雙方透過完善的反饋機制溝通並滿足客戶的客製化需求，以強化客戶對本公司產品及專業服務之黏著度。

(十)董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無此情形。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司營運穩健，獲利良好，董事或持股大於百分之十之大股東，最近年度及截至年報刊印日止並無股權大量移轉之情事，公司之經營權非常穩定。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：

本公司 110 年 7 月離職之黃姓前員工於 112 年對本公司提起勞資爭議損害賠償，苗栗地方法院勞動法庭安排雙方於 112 年 8 月 25 日進行調解。本案於 114 年 3 月 10 日在苗栗地方法院已被裁定駁回，目前黃姓前員工提起高院上訴，案件正在進行中，本公司係依勞基法規定資遣黃姓前員工，且迄今已逾三年，其主張事項並無理由，該爭議對本公司之財務、業務尚不致產生重大不利影響。此外，本公司最近二年度及截至年報刊印日止並無其他勞資糾紛之情事。

(十三)其他重要風險及因應措施：無此情形。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：請參閱公開資訊觀測站。查閱路徑如下：

公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區

(https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

四、其他必要補充說明事項：無。

晶呈科技股份有限公



董事長：陳亞理



